

TPS3704x 四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器

1 特性

- 多达四个独立电压监控器通道：
 - 固定和可调窗口、UV 或 OV 电压选项。有关可用选项，请参阅表 4-1。
 - 易于使用的[计算器工具](#)，适用于可调版本
 - 高阈值精度： $\pm 0.25\%$ (典型值)
 - 内置精密迟滞：0.75% (典型值)
 - 固定延时时间选项
 - 开漏输出
- 旨在支持[基于 Arm 的处理器](#) (如 TDA4、Sitara AM33xx 以及高级 FPGA 和 SOC)
- 低静态电流：15 μA (最大值)
- 温度范围：-40°C 至 +125°C
- [符合功能安全标准](#)
 - 系统可满足 SIL 3 等级要求
 - 硬件可满足 SIL 1 等级要求

2 应用

- [工厂自动化](#)
- [楼宇自动化](#)
- [医疗](#)
- [电机驱动器](#)
- [电网基础设施](#)
- [无线基础设施](#)
- [数据中心和企业计算](#)

3 说明

TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器，可配置为四通道、三通道或双通道。各通道的阈值精度为 $\pm 1\%$ 。该器件采用 8 引脚

(1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装，可实现小尺寸解决方案。TPS3704x 支持精确阈值检测并具有高分辨率，非常适合采用低电压电源轨且电源容差裕度非常小的系统。内置低阈值迟滞和固定复位延迟，可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。

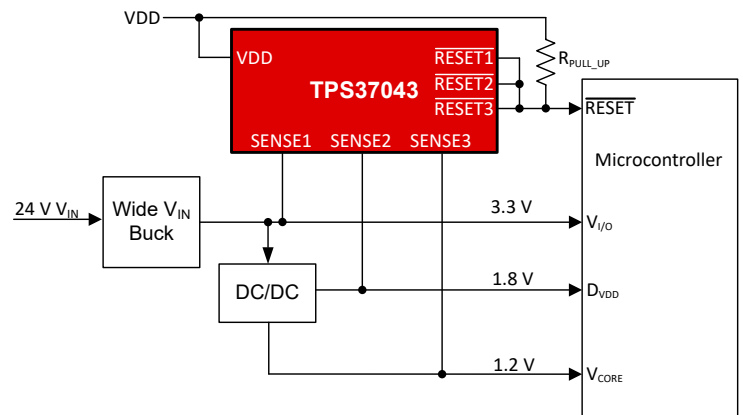
TPS3704x 无需任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值，因此进一步优化了整体精度、成本和解决方案尺寸，提高了安全系统的可靠性。

独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的轨电压，也可用作按钮输入。SENSEx 引脚支持使用可选的外部电阻器。TPS3704x 上的所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测，其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。

器件信息

器件型号	封装 (1)	封装尺寸 (标称值)
TPS3704x	DDF (8 引脚 SOT-23)	1.6mm x 2.9mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



典型应用电路



内容

1 特性	1	7.3 特性说明	18
2 应用	1	7.4 器件功能模式	20
3 说明	1	8 应用和实施	21
4 器件命名规则	3	8.1 应用信息	21
5 引脚配置和功能	5	8.2 典型应用	23
6 规格	7	8.3 电源相关建议	26
6.1 绝对最大额定值.....	7	8.4 布局	27
6.2 ESD 等级.....	7	9 器件和文档支持	28
6.3 建议运行条件.....	7	9.1 器件命名规则.....	28
6.4 热性能信息.....	7	9.2 接收文档更新通知.....	29
6.5 电气特性.....	8	9.3 支持资源.....	29
6.6 时序要求.....	9	9.4 商标.....	29
6.7 时序图.....	10	9.5 静电放电警告.....	29
6.8 典型特性.....	12	9.6 术语表.....	30
7 详细说明	16	10 修订历史记录	30
7.1 概述.....	16	11 机械、封装和可订购信息	30
7.2 功能方框图.....	16		

4 器件命名规则

图 4-1 展示了器件命名规则，用于比较不同的器件型号。有关更详细的说明，请参阅表 9-1。有关可用器件型号的信息，请参阅表 4-1 或表 9-2。

表 4-1. 器件阈值表

可订购器件名称	型号 ⁽³⁾	通道数量	复位时间	SENSE1 ^{(1) (2)}	SENSE2 ^{(1) (2)}	SENSE3 ^{(1) (2)}	SENSE4 ^{(1) (2)}
TPS37042BJOFDDFRQ1	ADJ	2	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	-	-
TPS37042A3OFDDFRQ1	修复	2	10ms	3.3V (±5%)	1.2V (±5%)	-	-
TPS37042ZJOFDDFRQ1	修复	2	10ms	1.95V (±4%)	3.8V (±6%)	-	-
TPS37043DJOFDDFR	可调/固定	3	10ms	3.3V (-11%)	1.2V (-11%)	0.8V (-8%)	-
TPS37043A4OFDDFRQ1	修复	3	10ms	2.8V (±5%)	1.8V (±5%)	1.2V (±5%)	-
TPS37043A8OFDDFRQ1	修复	3	10ms	3.3V (±5%)	1.8V (±5%)	1.0V (±5%)	-
TPS37043CPOFDDFRQ1	可调/固定	3	10ms	3.3V (±4%)	0.75V (±4%)	0.8V (±3%)	-
TPS37043ZJOFDDFRQ1	修复	3	10ms	0.95V (±4%)	1.35V (±4%)	1.8V (±4%)	-
TPS37043LJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.4V (±5%)	0.4V (±5%)	0.8V (±5%)	-
TPS37043CJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	-
TPS37043MJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.4V (±7%)	0.4V (±7%)	0.8V (±7%)	-
TPS37043A5OFDDFRQ1	修复	3	10ms	3.3V (±4%)	1.8V (±4%)	1.2V (±4%)	-
TPS37043BJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	-
TPS37044BJOFDDFR	ADJ	4	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)
TPS37044LJOJDDFR	ADJ	4	35ms	0.4V (±5%)	0.4V (±5%)	0.8V (±5%)	0.8V (±5%)
TPS37044BJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)
TPS37044CJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)
TPS37044MJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.4V (±7%)	0.4V (±7%)	0.8V (±7%)	0.8V (±7%)
TPS37044A4OGDDFRQ1	修复	4	15ms	3.3V (±8%)	1.8V (±4%)	1.15V (±6%)	1.15V (±6%)

(1) 所列百分比表示窗口容差，请参阅图 6-1 以了解更多信息

(2) 0.8V 和 0.4V 的 VIT 阈值表示可调通道

(3) ADJ 表示由外部电阻分压器设置的可调电压阈值，请参阅节 8.1.2 以了解更多信息

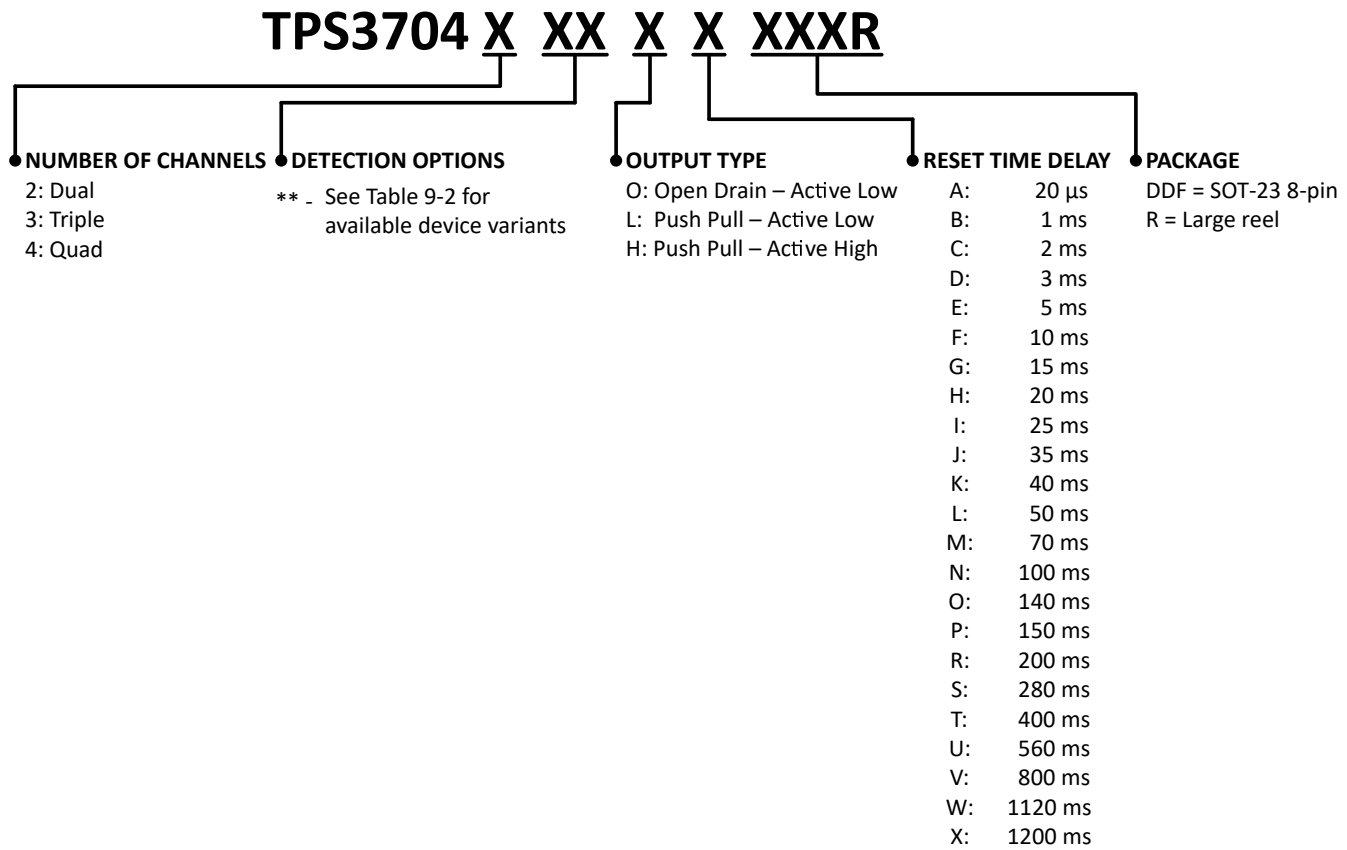


图 4-1. 器件命名规则

5 引脚配置和功能

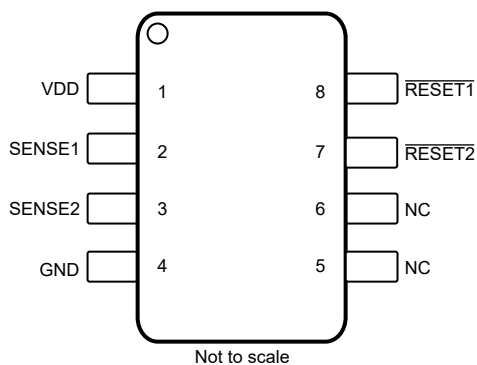


图 5-1. SOT-23 8 引脚 DDF 封装
TPS37042
(顶视图)

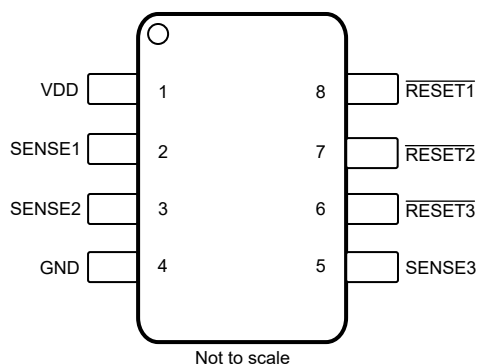


图 5-2. SOT-23 8 引脚 DDF 封装
TPS37043
(顶视图)

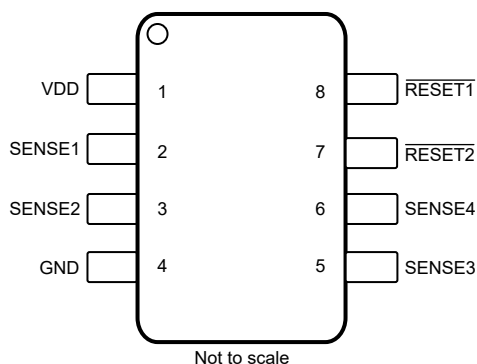


图 5-3. SOT-23 8 引脚 DDF 封装
TPS37044
(顶视图)

表 5-1. 引脚功能

名称	引脚				I/O	说明
	TPS37041	TPS37042	TPS37043	TPS37044		
VDD	1	1	1	1	I	电源输入。使用 0.1 μ F 电容器旁路至 GND。
SENSE1	2	2	2	2	I	直接连接到受监控的电压。当 SENSE1 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 被置为有效。此 SENSE1 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044 (四通道版本)，当 SENSE1 或 SENSE2 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 置为有效。对于有噪声的应用，可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器，以获得出色性能。如果不使用该输入引脚，可以将其保持悬空。
SENSE2	-	3	3	3	I	直接连接到受监控的电压。当 SENSE2 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 被置为有效。SENSE2 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044 (四通道版本)，当 SENSE1 或 SENSE2 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 置为有效。对于有噪声的应用，可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器，以获得出色性能。如果不使用该输入引脚，可以将其保持悬空。
SENSE3	-	-	5	5	I	直接连接到受监控的电压。当 SENSE3 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET3/RESET3}}$ 被置为有效。SENSE3 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044 (四通道版本)，当 SENSE3 或 SENSE4 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 置为有效。对于有噪声的应用，可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器，以获得出色性能。如果不使用该输入引脚，可以将其保持悬空。
SENSE4	-	-	-	6	I	直接连接到受监控的电压。对于 TPS37044 (四通道版本)，当 SENSE3 或 SENSE4 超出窗口阈值时， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 置为有效。对于有噪声的应用，可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器，以获得出色性能。如果不使用该输入引脚，可以将其保持悬空。
RESET1/ RESET1	8	8	8	8	O	当 SENSE1 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 置为有效。 在 SENSE1 回到窗口阈值内后， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 在复位超时期间保持有效。该低电平有效开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。对于 TPS37044，当 SENSE1 或 SENSE2 超出上述窗口阈值时， $\overline{\text{RESET1/RESET1}}$ 置为有效。如果该引脚未使用，可以将其保持悬空。
RESET2/ RESET2	-	7	7	7	O	当 SENSE2 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 置为有效。 在 SENSE2 回到窗口阈值内后， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 在复位超时期间保持有效。该低电平有效开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。对于 TPS37044，当 SENSE3 或 SENSE4 超出上述窗口阈值时， $\overline{\text{RESET2/RESET2}}$ 置为有效。如果该引脚未使用，可以将其保持悬空。
RESET3/ RESET3	-	-	6	-	O	当 SENSE3 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时， $\overline{\text{RESET3/RESET3}}$ 置为有效。 在 SENSE3 回到窗口阈值内后， $\overline{\text{RESET3/RESET3}}$ 在复位超时期间保持有效。该低电平有效开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。如果该引脚未使用，可以将其保持悬空。
GND	4	4	4	4	-	接地
NC	3、5、6、 7	5、6	-	-	-	无连接

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电压	V _{DD}	-0.3	6.5	V
	V _{RESET1} 、V _{RESET2} 、V _{RESET3}	-0.3	6.5	V
	V _{SENSE1} 、V _{SENSE2} 、V _{SENSE3} 、V _{SENSE4}	-0.3	6.5	V
电流	I _{RESET1} 、I _{RESET2} 、I _{RESET3} 灌电流		±20	mA
温度 ⁽²⁾	持续总功率耗散	请参阅“热性能信息”		
	运行结温, T _J	-40	150	°C
	自然通风工作温度范围, T _A	-40	150	°C
	贮存温度, T _{stg}	-65	150	°C

- (1) 应力超出“绝对最大额定值 (AMR)”下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级，这并不表示器件在这些条件下以及在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 由于该器件的耗散功率较低，因此假设 T_J = T_A。

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±750	

- (1) JEDEC 文件 JEP155 指出：500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产
- (2) JEDEC 文件 JEP157 指出：250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产

6.3 建议运行条件

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{DD}	电源引脚电压	1.7		6.0	V
V _{SENSE1,2,3,4}	输入引脚电压	0		6.0	V
V _{RESET1} 、V _{RESET2} 、V _{RESET3}	输出引脚电压	0		6.0	V
I _{RESET1} 、I _{RESET2} 、I _{RESET3} 灌电流	输出引脚灌电流	0.3		5	mA
T _A	自然通风条件下的工作温度范围	-40		125	°C

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TPS3704x	单位
		DDF	
		引脚	
R _{θJA}	结至环境热阻	121.5	°C/W
R _{θJC(top)}	结至外壳（顶部）热阻	60.6	°C/W
R _{θJB}	结至电路板热阻	42.3	°C/W
Ψ _{JT}	结至顶部特征参数	2.2	°C/W
Ψ _{JB}	结至电路板特征参数	42.1	°C/W

热指标 ⁽¹⁾		TPS3704x	单位
		DDF	
		引脚	
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用报告。

6.5 电气特性

$1.7V \leq V_{DD} \leq 6.0V$, $\overline{RESETx}$ 电压 (V_{RESETx}) = $10k\Omega$ 至 V_{DD} , $\overline{RESETx}$ 负载 = $10pF$, 并且在自然通风条件下的工作温度范围 (- $40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$) 内测得, 除非另有说明。典型值为 $T_A = 25^{\circ}C$ 下的值, 在典型条件 $V_{DD} = 3.3V$ 下。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	电源电压		1.7		6.0	V
UVLO	欠压锁定 ⁽¹⁾	V_{DD} 降至 1.7V 以下	1.2	1.4	1.6	V
UVLO _(HYS)	UVLO 迟滞 ⁽²⁾	V_{DD} 升至低于 1.7V		65		mV
V_{POR}	上电复位电压 ⁽³⁾	$V_{OL(MAX)} = 0.3V$, $I_{OUT} = 15\mu A$			0.7	V
V_{IT} 范围	阈值编程范围		0.4		5.55	V
$V_{IT-(UV)}$	UV 精度 ($25^{\circ}C$)			0.1		%
$V_{IT+(OV)}$	OV 精度 ($25^{\circ}C$)			0.1		%
TOL _{min}	容差编程最小值			3		%
TOL _{max}	容差编程最大值			11		%
THR RES Low	阈值编程分辨率低	$V_{IT} \leq 0.8V$		20		mV/阶跃
THR RES Mid	阈值编程分辨率中	$0.8V < V_{IT} \leq 4.0V$		0.5		%/阶跃
THR RES High	阈值编程分辨率高	$V_{IT} > 4.0V$		20		mV/阶跃
V_{IT}	绝对阈值精度 (包括容差)	$V_{IT} < 0.8V$	-1.6		1.6	%
V_{IT}	绝对阈值精度 (包括容差)	$V_{IT} = 0.8V$ 至 $5.55V$	-1		1	%
V_{HYS}	$V_{IT} < 0.80V$		1.1	1.4	1.7	%
V_{HYS}	$V_{IT} \geq 0.80V$		0.40	0.75	1	%
I_{DD}	TPS3704x	$V_{DD} \leq 6.0V$		5.5	15	μA
I_{SENSEx}	输入电流, SENSEx 引脚	$V_{SENSEx} = 5.5V$		1	2.5	μA
I_{SENSE_ADJ}	输入电流, SENSE 引脚 (旁路内部电阻分压器) - 可调版本	$V_{SENSEx} = 5.5V$			350	nA
V_{OL}	低电平输出电压	$V_{DD} = 1.7V$, $I_{SINK} = 0.4mA$			300	mV
V_{OL}	低电平输出电压	$V_{DD} = 2V$, $I_{SINK} = 3mA$			300	mV
V_{OL}	低电平输出电压	$V_{DD} = 6.0V$, $I_{SINK} = 5mA$			300	mV
$I_{(lk)}$	开漏输出漏电流	$V_{DD} = V_{RESETx} = 6.0V$			350	nA

(1) 当 V_{DD} 降至 UVLO 以下时, $\overline{RESETx}$ 引脚被驱动为低电平。

(2) 迟滞与跳闸点 ($V_{IT-(UV)}$ 、 $V_{IT+(OV)}$) 相关。

(3) V_{POR} 是受控输出状态下的最小 V_{DD} 电压电平。压摆率 = $100mV/\mu s$ 。

6.6 时序要求

$1.7V \leq V_{DD} \leq 6.0V$, $\overline{RESETx}$ 电压 ($V_{\overline{RESETx}}$) = $10k\Omega$ 至 V_{DD} , $\overline{RESETx}$ 负载 = $10pF$, 并且在自然通风条件下的工作温度范围 ($-40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$) 内测得, 除非另有说明。典型值为 $T_A = 25^{\circ}C$ 下的值, 在典型条件 $V_{DD} = 3.3V$ 下。

参数		测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
t_D	复位释放延时时间	固定延迟选项 $t_D < 4ms$, 过驱 = 10%	-40	t_D	40	%
t_D	复位释放延时时间	固定延迟选项 $t_D > 5ms$, 过驱 = 10%	-30	t_D	30	%
t_{PD}	传播检测延迟 ⁽¹⁾	固定延时时间 $t_D > 1ms$, 过驱 10%			10	μs
$t_{GI(VIT-)}$	毛刺抑制欠压 (5% 过驱) ⁽²⁾			2		μs
$t_{GI(VIT+)}$	毛刺抑制过压 (5% 过驱) ⁽²⁾			2		μs
t_R	输出上升 (推挽) ^{(2) (3)}			25		ns
t_R	输出上升时间 (开漏) ^{(2) (3)}			2.2		μs
t_F	输出下降时间 ^{(2) (3)}			0.2		μs
t_{STRT}	启动延迟 ⁽⁴⁾			1		ms

- (1) 从阈值跳闸点 ($V_{IT-(UV)}$ 或 $V_{IT+(OV)}$) 到 $\overline{RESETx}$ V_{OL} 电压之间的 t_{PD}
- (2) 高于阈值 5% 的过驱。过驱 % = $[(V_{SENSEx} - V_{IT}) / V_{IT}]$; 其中 V_{IT} 代表 $V_{IT-(UV)}$ 或 $V_{IT+(OV)}$
- (3) 在上升时间, 输出转换从 V_{OL} 到 V_{OH} 或 ($V_{\overline{RESETx}}$); 在下降时间, 从 V_{OH} 或 ($V_{\overline{RESETx}}$) 到 V_{OL} 。
- (4) 在上电序列期间, 在输出处于正确状态之前, V_{DD} 必须达到或高于 $V_{DD(MIN)}$ 并至少维持 $t_{STRT} + t_D$ 的时间。当 V_{DD} 处于 $V_{DD(min)}$ 和 $VPOR$ 之间时, $\overline{RESETx}$ 引脚将启用

6.7 时序图

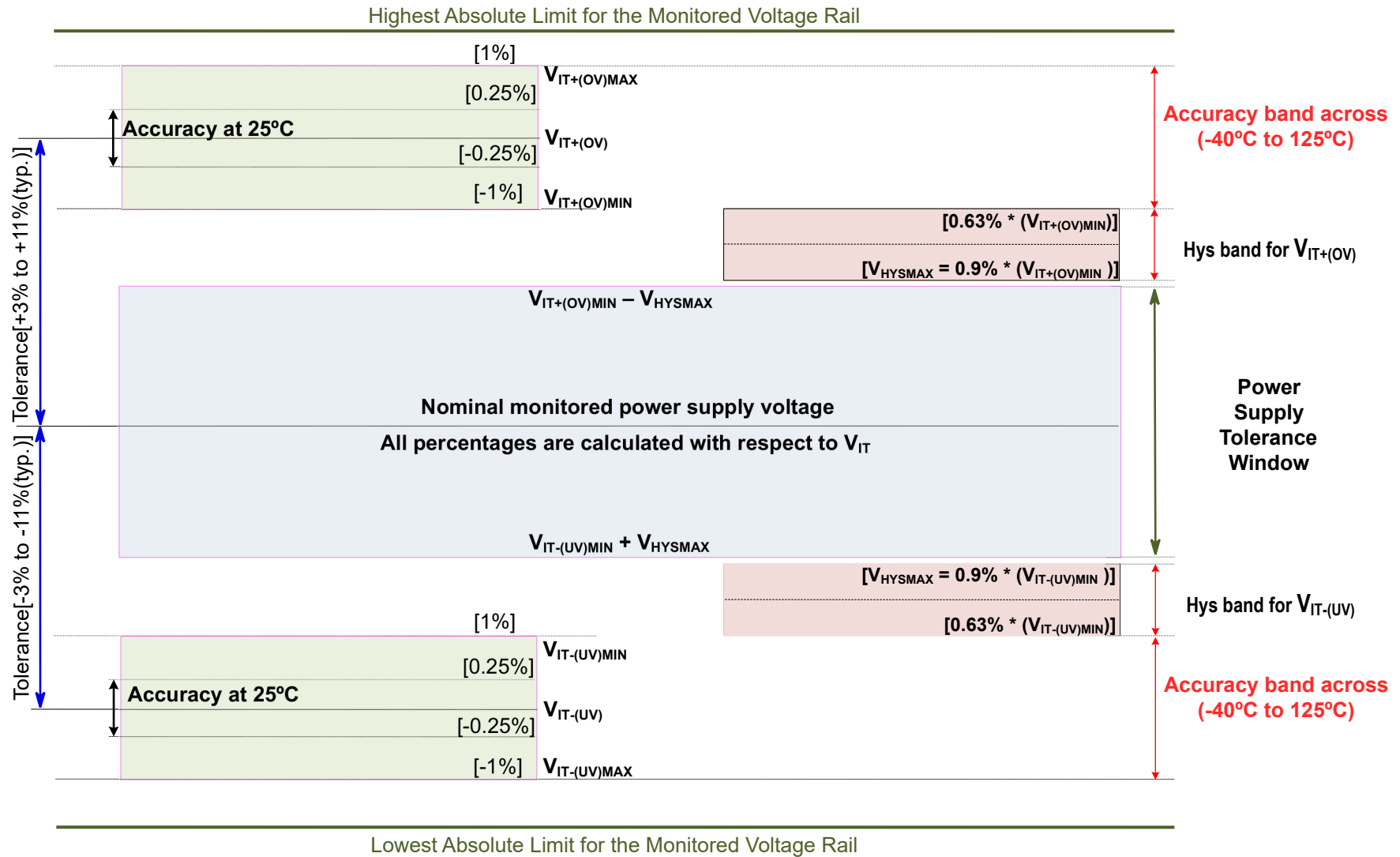
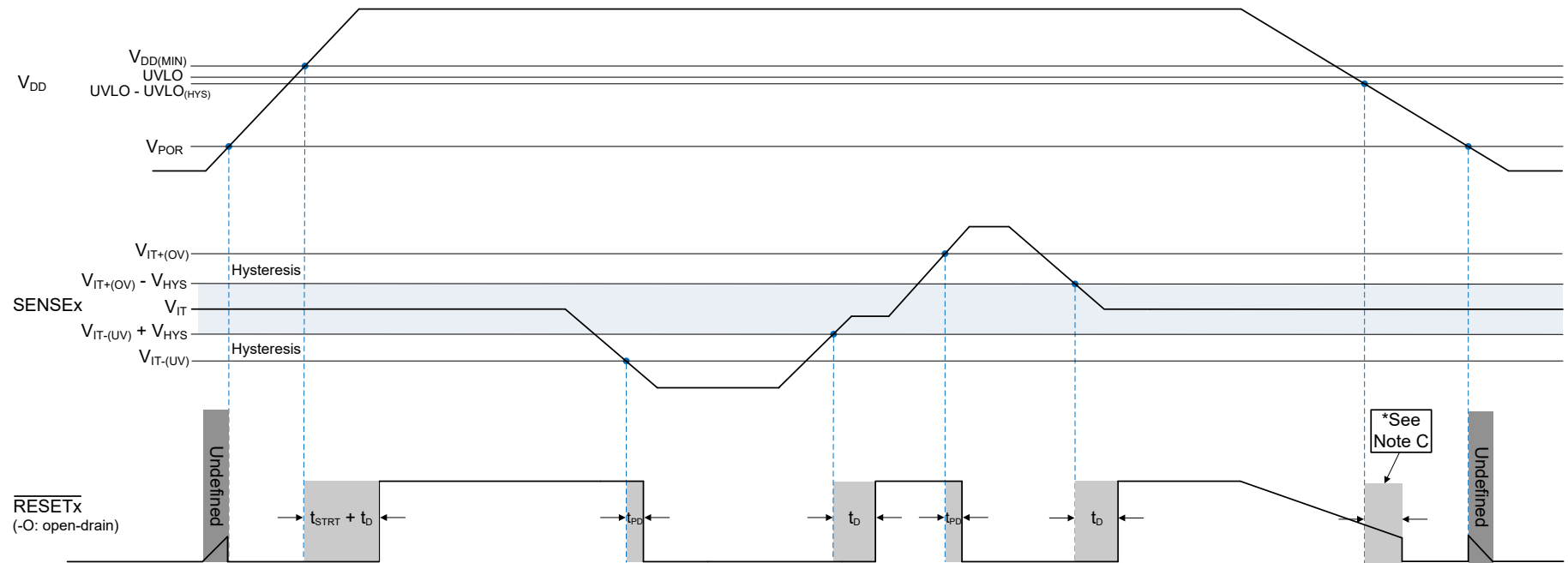


图 6-1. 电压阈值和迟滞精度



- 开漏时序图假设 $\overline{RESETx}$ / $RESETx$ 引脚通过外部上拉电阻器连接到 VDD。
- 请注意，图 6-2 展示了 VDD 下降压摆率较慢或 VDD 衰减时间远大于传播检测延迟 (t_{PD}) 时间。
- 当 VDD 低于 $UVLO - UVLO_{(HYS)}$ 阈值时，经过一段延时时间（典型值为 $100 \mu s$ ）后， $\overline{RESETx}$ / $RESETx$ 会被置为有效。

图 6-2. SENSEx 时序图

6.8 典型特性

典型特性显示了 TPS3704x 器件的典型性能。测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $R_{\text{pull-upx}} = 10\text{k}\Omega$, $C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$, 除非另有说明。

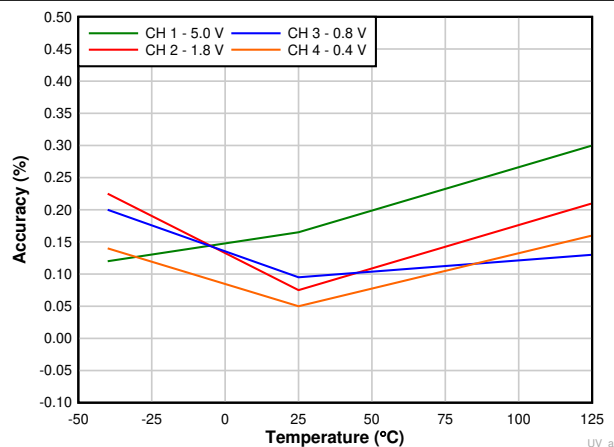


图 6-3. 欠压精度与温度间的关系

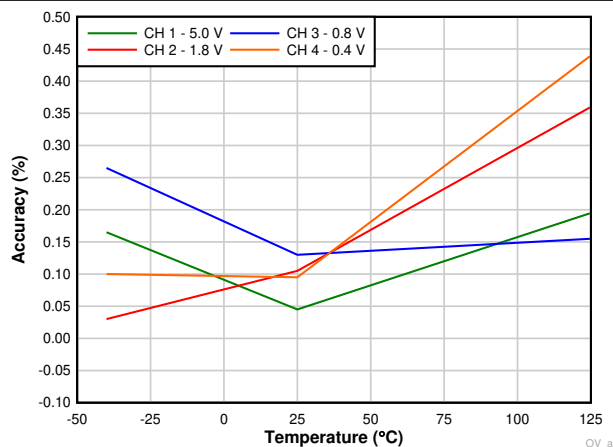


图 6-4. 过压精度与温度间的关系

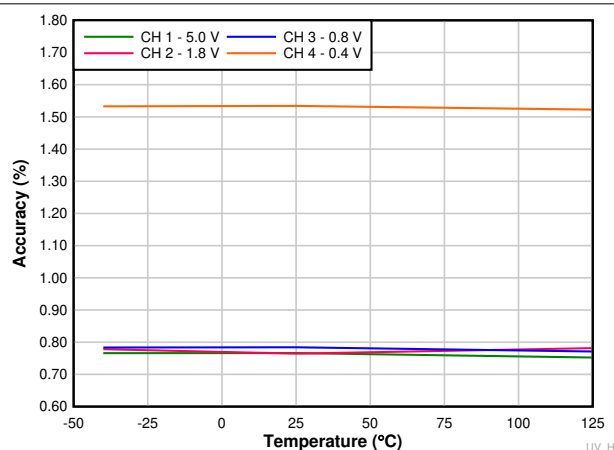


图 6-5. 欠压迟滞电压精度与温度间的关系

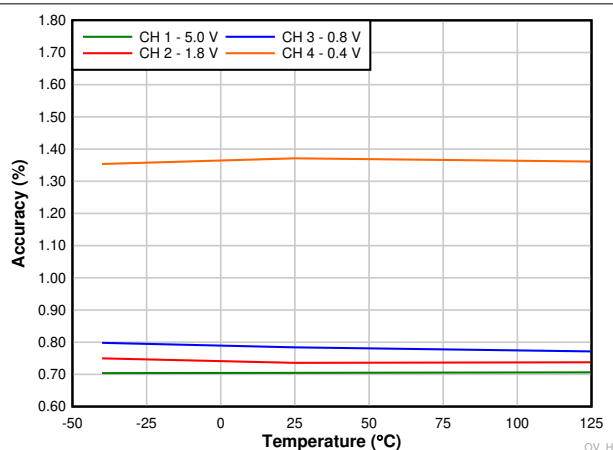
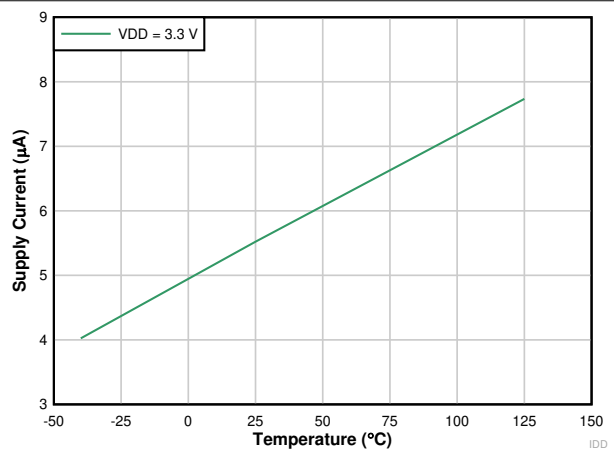


图 6-6. 过压迟滞电压精度与温度间的关系



输出 ($\overline{\text{RESETx}}$ 引脚) = 高电平

图 6-7. 电源电流与温度间的关系

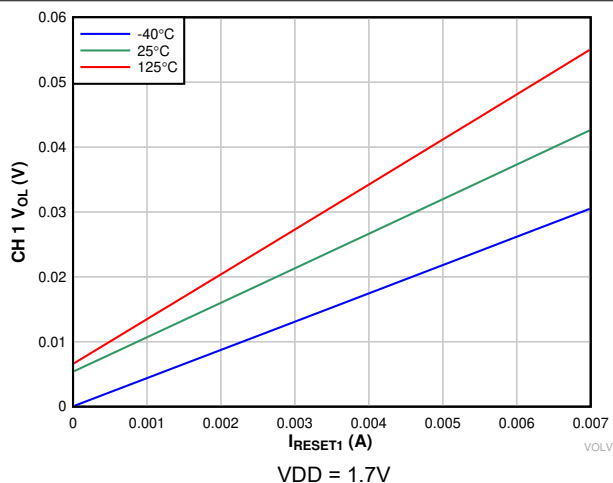


图 6-8. 低电平 CH 1 输出电压与 RESET1 电流间的关系

6.8 典型特性 (续)

典型特性显示了 TPS3704x 器件的典型性能。测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $R_{\text{pull-upx}} = 10\text{k}\Omega$, $C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$, 除非另有说明。

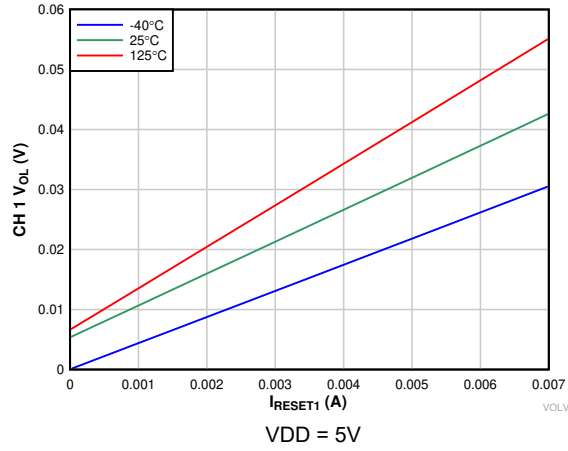


图 6-9. 低电平 CH 1 输出电压与 $\overline{\text{RESET1}}$ 电流间的关系

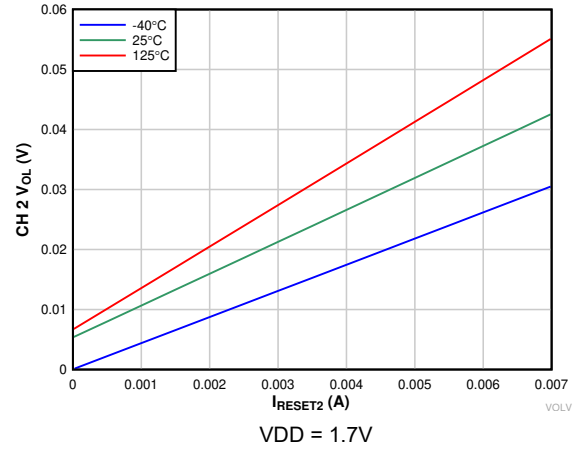


图 6-10. 低电平 CH 2 输出电压与 $\overline{\text{RESET2}}$ 电流间的关系

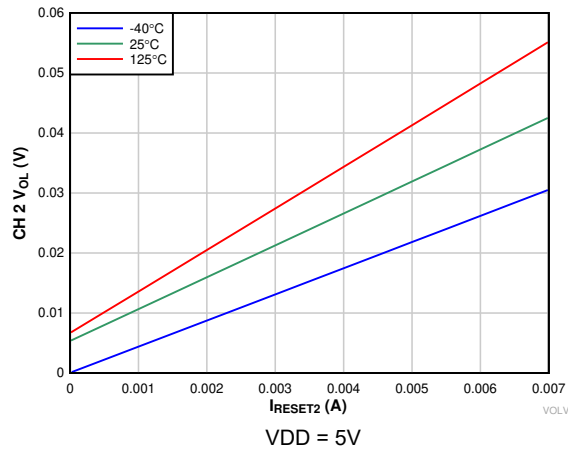


图 6-11. 低电平 CH 2 输出电压与 $\overline{\text{RESET2}}$ 电流间的关系

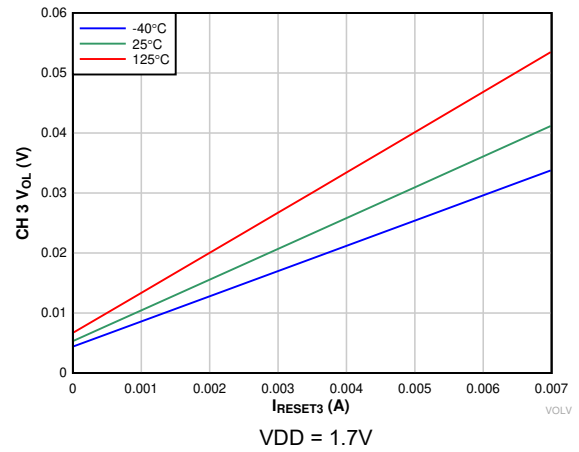


图 6-12. 低电平 CH 3 输出电压与 $\overline{\text{RESET3}}$ 电流间的关系

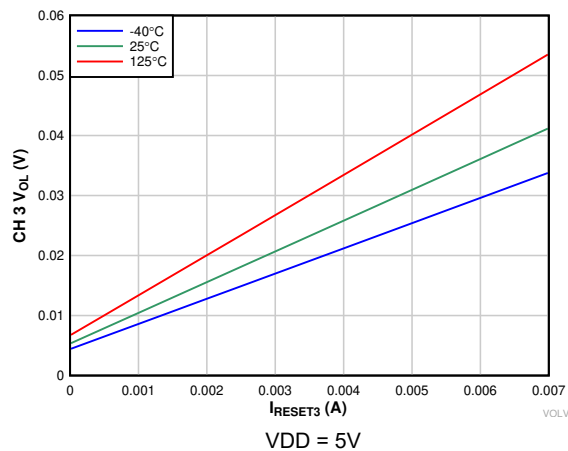


图 6-13. 低电平 CH 3 输出电压与 $\overline{\text{RESET3}}$ 电流间的关系

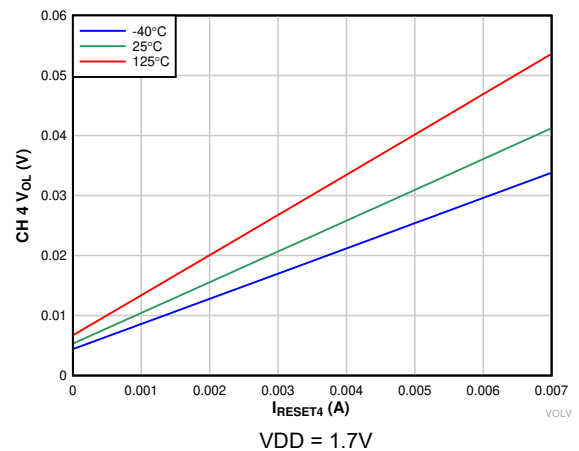


图 6-14. 低电平 CH 4 输出电压与 $\overline{\text{RESET4}}$ 电流间的关系

6.8 典型特性 (续)

典型特性显示了 TPS3704x 器件的典型性能。测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $R_{\text{pull-upx}} = 10\text{k}\Omega$, $C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$, 除非另有说明。

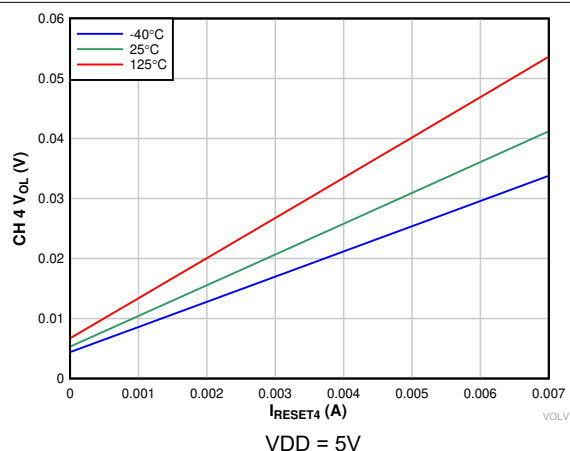


图 6-15. 低电平 CH 4 输出电压与 RESET4 电流间的关系

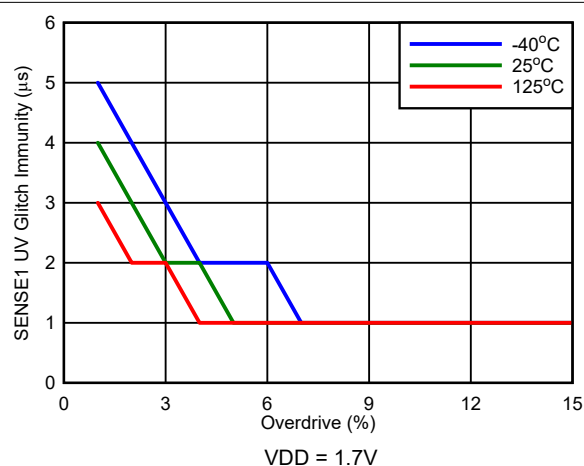


图 6-16. SENSE1 毛刺抑制 ($V_{\text{IT-}}$) 与过驱间的关系

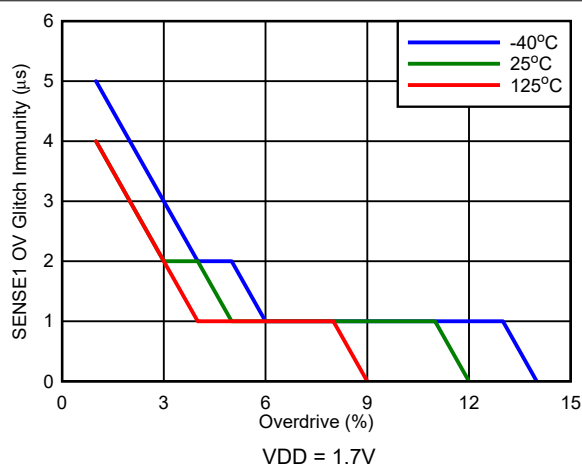


图 6-17. SENSE1 毛刺抑制 ($V_{\text{IT+}}$) 与过驱间的关系

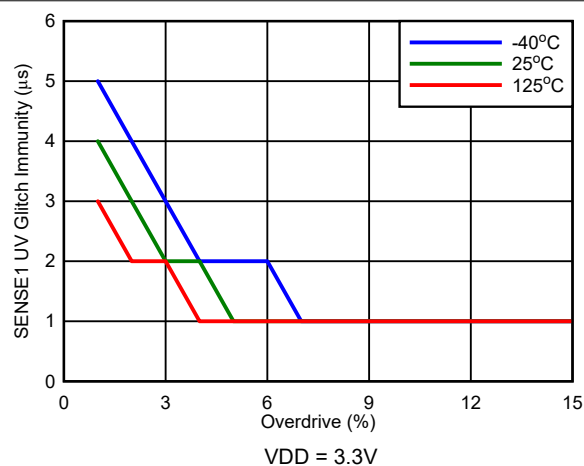


图 6-18. SENSE1 毛刺抑制 ($V_{\text{IT-}}$) 与过驱间的关系

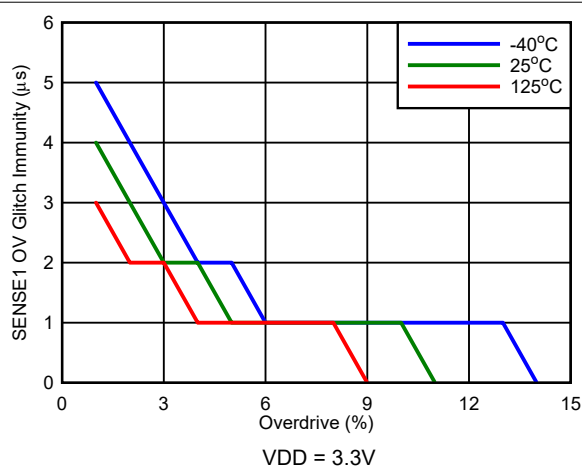


图 6-19. SENSE1 毛刺抑制 ($V_{\text{IT+}}$) 与过驱间的关系

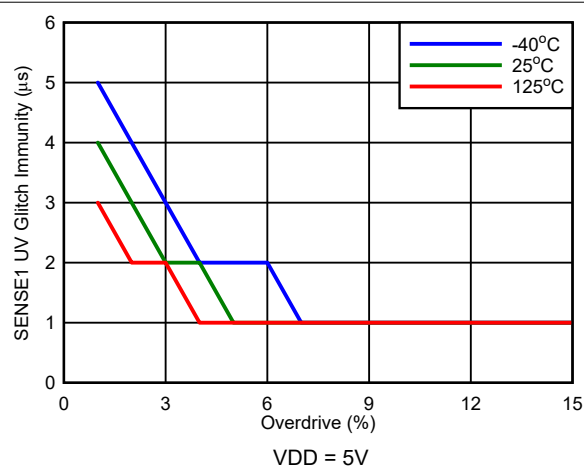


图 6-20. SENSE1 毛刺抑制 ($V_{\text{IT-}}$) 与过驱间的关系

6.8 典型特性 (续)

典型特性显示了 TPS3704x 器件的典型性能。测试条件为 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, $R_{\text{pull-upx}} = 10\text{k}\Omega$, $C_{\text{LOAD}} = 50\text{pF}$, 除非另有说明。

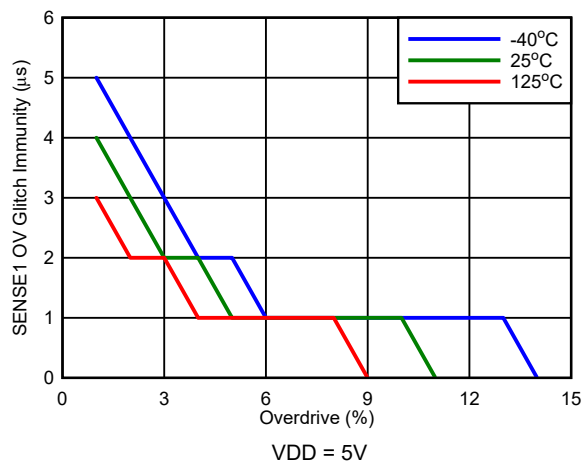


图 6-21. SENSE1 毛刺抑制 (V_{IT+}) 与过驱间的关系

7 详细说明

7.1 概述

TPS3704x 是一系列四通道、三通道和双通道高精度电压监控器，其中每个通道都具有过压和欠压检测功能。TPS3704x 具有高精度窗口阈值电压，其中阈值上限和下限可针对对称或非对称容差进行定制。当检测电压超出过压和欠压阈值时，TPS3704x 的复位信号会置为生效，并具有故障检测延时时间 ($t_{PD} = 10 \mu s$ 最大值)。

TPS3704x 包括用于设置器件内部过压和欠压阈值的电阻器。要确保外部电阻器精度无需额外的裕度，因此这些内部电阻器可减少元件数量并极大地简化设计。TPS3704x 的集成度可为任何应用提供总体较小的解决方案尺寸。

TPS3704x 能够以高分辨率监控任何电压轨 ($V_{IT} \leq 0.8V : 20mV$ 阶跃/

$V_{IT} > 0.8V : 0.5\%$ 或 $20mV$ 阶跃，以较低者为准)。TPS3704x 中的每个通道都可以独立配置为窗口、OV 或 UV 监控器。此外，每个通道的 V_{IT} 阈值电压可以是不对称的。例如，配置为过压监控器的通道可以设置为 +5% 容差，而欠压通道监控器可以设置为 -4% 容差。如果配置了窗口监控器，则电压阈值容差可以是对称的，也可以是不对称的。

TPS3704x 包含 $20 \mu s$ 至 $1200ms$ 的固定复位延时时间 (t_D) 选项，并且可以在保持 $15 \mu A$ (最大值) 超低 I_Q 电流的同时监控多达四个通道。

7.2 功能方框图

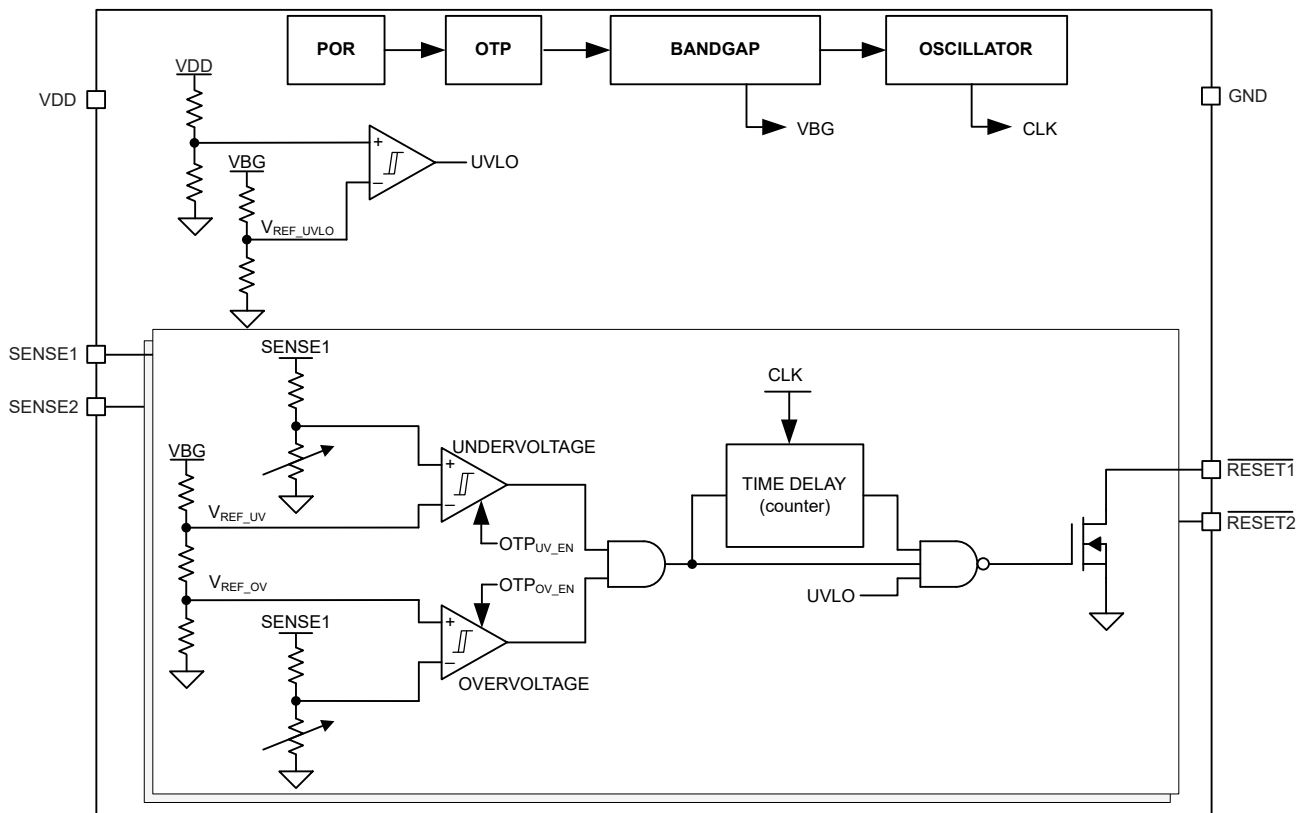


图 7-1. TPS37042 双通道功能方框图

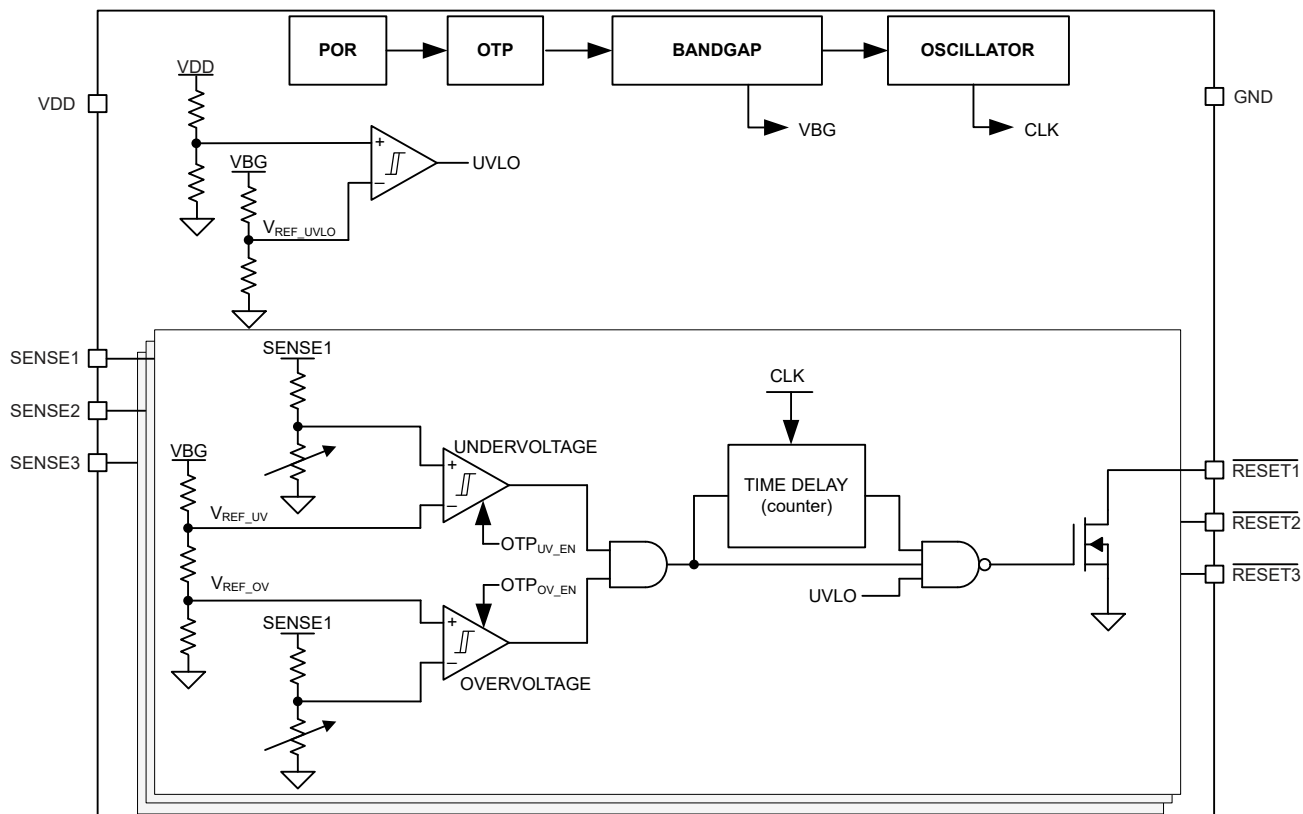


图 7-2. TPS37043 三通道功能方框图

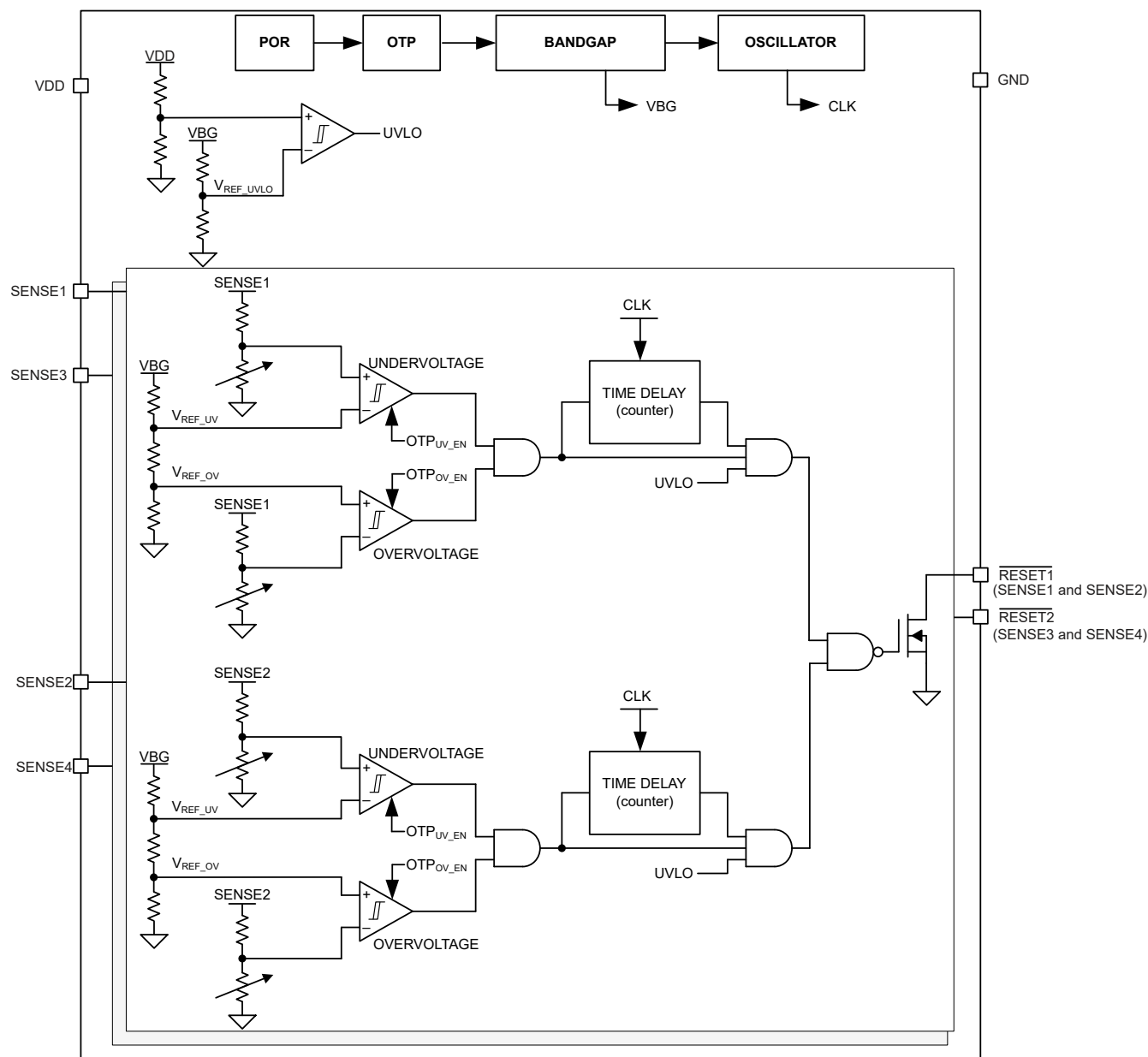


图 7-3. TPS37044 四通道功能方框图

*有关可用的电压、窗口容差、延时时间和 UV/OV 阈值选项，请参阅表 9-2。

7.3 特性说明

7.3.1 VDD

TPS3704x 设计为在 1.7V 至 6V 的输入电源电压范围内工作。SENSEx 引脚由内部比较器监控。VDD 还充当内部带隙、内部稳压器、状态机、缓冲器和其他控制块的电源。当 $VDD > V_{POR}$ 时，复位信号处于已知状态。当 VDD 低于最小 VDD 电压时，欠压锁定会强制将复位输出置为有效。

此器件不需要 VDD 电容器；但是，如果输入电源有噪声，则最好在 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个 0.1 μF 至 1 μF 的旁路电容器，以确保有足够的电荷可供器件正确上电。为了使器件能够完全正常工作，VDD 需要在启动延迟

$(t_{\text{STRT}} + t_{\text{D}})$ 时间内恰好为或高于 $V_{\text{DD(MIN)}}$ 。

7.3.2 SENSEx 输入

无论使用的器件电源电压如何，SENSEx 输入都可以监控 0V 至 5.55V 的电源轨。SENSEx 引脚用于监控关键电压轨或按钮输入。如果该引脚上的电压低于 $V_{IT-(UV)}$ 以下或高于 $V_{IT+(OV)}$ ，则 $\overline{RESETx}/RESETx$ 会被置为有效。当 SENSEx 引脚上的电压高于正阈值电压 $V_{IT-(UV)} + V_{HYS}$ 或低于负阈值电压 $V_{IT+(OV)} - V_{HYS}$ 时， $\overline{RESETx}/RESETx$ 会在设置的 $\overline{RESETx}/RESETx$ 延时时间后置为无效。内部比较器具有内置迟滞，即使受监控的电压轨发生微小变化，也能确保明确定义的 $\overline{RESETx}/RESETx$ 置为有效和无效。

TPS3704x 将比较器与精密基准电压和经过修整的电阻分压器相结合。该配置可优化器件精度，因为精度和性能规格中考虑了所有电阻器容差。TPS3704x 器件相对不受 SENSEx 引脚上短时瞬态的影响。尽管在大多数情况下不是必需的，但对于有噪声的应用，良好的模拟设计实践是在 SENSEx 输入端放置一个 10nF 至 100nF 的旁路电容器，以便降低对受监控信号上瞬态电压的敏感度。

7.3.2.1 抗 SENSEx 引脚电压瞬态干扰

TPS3704x 不受输入 SENSEx 引脚上短电压瞬态尖峰的影响。对瞬态的敏感度取决于瞬态持续时间和瞬态的过驱（幅度）。

过驱是指 V_{SENSEx} 超过指定阈值的程度，知道这一点很重要，因为过驱越小， $(\overline{RESETx}/RESETx)$ 输出的响应就越慢。阈值过驱的计算结果是超出指定阈值的百分比，如方程式 1 所示：

$$\text{Overdrive \%} = |(V_{SENSEx} - (V_{IT-(UV)} \text{ or } V_{IT+(OV)})) / V_{IT} (\text{Nominal}) \times 100\%| \quad (1)$$

其中：

- V_{SENSEx} 是 SENSEx 引脚上的电压
- $V_{IT} (\text{Nominal})$ 是标称阈值电压
- $V_{IT-(UV)}$ 和 $V_{IT+(OV)}$ 表示实际欠压或过压跳闸电压

7.3.2.1.1 SENSEx 迟滞

过压比较器和欠压比较器包含内置迟滞，可提供抗噪性并确保稳定运行。例如，如果 SENSEx 引脚上的电压低于 $V_{IT-(UV)}$ 或高于 $V_{IT+(OV)}$ ，则 $\overline{RESETx}/RESETx$ 置为有效。当 SENSEx 引脚上的电压介于正阈值电压和负阈值电压之间时， $\overline{RESETx}/RESETx$ 会在设置的 $\overline{RESETx}/RESETx$ 延迟时间后置为无效。图 7-4 展示了 $V_{IT-(UV)}$ 、 $V_{IT+(OV)}$ 与迟滞电压 (V_{HYS}) 之间的关系。

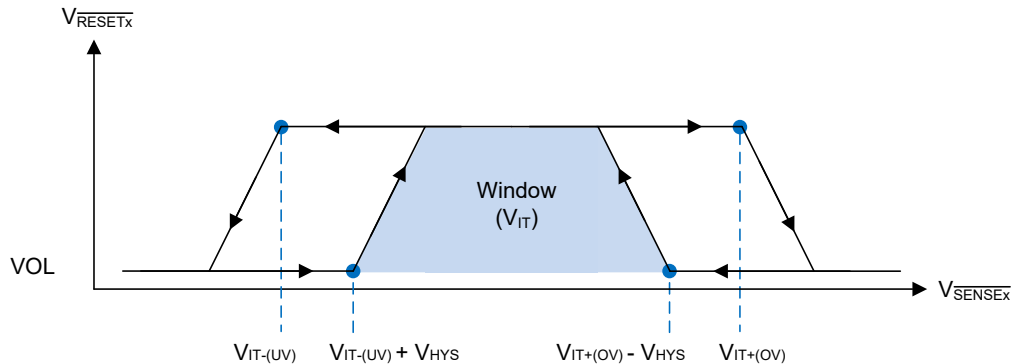


图 7-4. SENSEx 引脚迟滞

7.3.3 RESETx/RESETx

在典型的 TPS3704x 应用中， $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 输出连接到处理器的复位或使能输入[例如数字信号处理器 (DSP)、应用特定集成电路 (ASIC) 或其他处理器类型]或稳压器[例如直流/直流转换器或低压降稳压器 (LDO)]的使能输入。

TPS3704x 具有开漏低电平有效输出，此输出需要一个外部上拉电阻来将这些线路保持在高电平，从而达到所需的电压逻辑。将外部上拉电阻器连接到适当的电压轨，使输出端能够以正确的接口电压电平连接到其他器件。为了确保适当的电压电平，在选择外部上拉电阻值时要考虑一些因素。外部上拉电阻值由 V_{OL} 、输出容性负载和输出漏电流决定。这些值在

节 6.5 中指定。开漏输出可以作为与其他 $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 开漏引脚的线或逻辑进行连接。

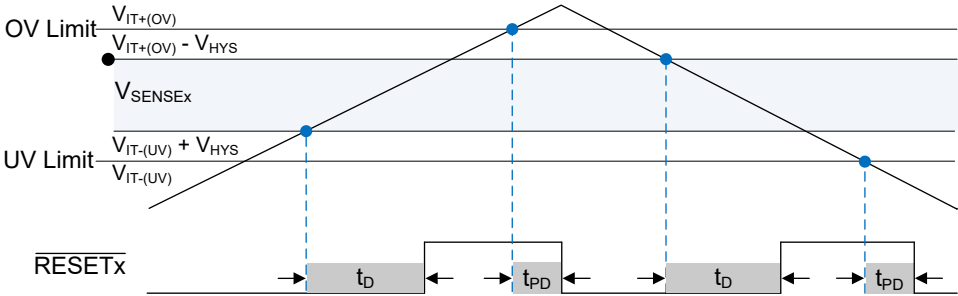


图 7-5. RESETx 输出

7.4 器件功能模式

表 7-1. 功能模式真值表

说明	条件	VDD 引脚	OUTPUT RESETx / (RESETx) PIN
正常运行	$V_{IT-(UV)} < \text{SENSEx} < V_{IT+(OV)}$	$V_{DD} > V_{DD(MIN)}$	高/ (低)
正常运行 (仅 UV)	$\text{SENSEx} > V_{IT-(UV)}$	$V_{DD} > V_{DD(MIN)}$	高/ (低)
过压检测	$\text{SENSEx} > V_{IT+(OV)}$	$V_{DD} > V_{DD(MIN)}$	低/ (高)
欠压检测	$\text{SENSEx} < V_{IT-(UV)}$	$V_{DD} > V_{DD(MIN)}$	低/ (高)
UVLO 已启用	$V_{IT-(UV)} < \text{SENSEx} < V_{IT+(OV)}$	$V_{POR} < V_{DD} < UVLO$	低/ (高)

7.4.1 正常运行 ($V_{DD} > V_{DD(MIN)}$)

当 V_{DD} 上的电压大于 $V_{DD(MIN)}$ 并持续大约 ($t_{STRT} + t_D$) 时， $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 输出状态将对应于 SENSEx 引脚电压相对于阈值限值的情况，当 SENSEx 电压超出阈值限值时， $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 电压将置为有效。

7.4.2 欠压锁定 ($V_{POR} < V_{DD} < UVLO$)

当 V_{DD} 上的电压低于器件 UVLO 电压但高于上电复位电压 (V_{POR}) 时，无论 SENSEx 引脚上的电压如何， $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 引脚都将被置为有效。

7.4.3 上电复位 ($V_{DD} < V_{POR}$)

当 V_{DD} 电压低于将有效输出内部下拉至 GND 所需的电压 (V_{POR}) 时， $\overline{\text{RESETx}}/\text{RESETx}$ 信号处于未定义状态，不能用于实现器件正常运行。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

8.1.1 电压阈值精度

电压监控要求因受器件的电源电压容差而异。由于 TPS3704x 具有高精度（最大值 $\pm 1\%$ ），该器件支持更宽的电源电压裕度和阈值余量，适用于小容差应用。

例如，以向 MCU 的内核电压轨供电的直流/直流稳压器为例。MCU 的容差为直流/直流稳压器标称输出电压的 $\pm 5\%$ 。用户设置 $\pm 4\%$ 的理想电压阈值，从而实现 $\pm 1\%$ 的阈值精度。由于 TPS3704x 的阈值精度为 $\pm 1\%$ ，因此用户拥有更大的电源电压裕度，从而可以轻松进行电源设计。由于电压纹波和瞬态电压窗口较大，因此直流/直流稳压器可以灵活地使用较小的输出电容器或电感器。最小系统电压和 MCU 的电压容差之间还存在余量，可确保在 TPS3704x 未发出复位信号的情况下，电源永远不会处于潜在故障区域。

图 8-1 展示了上述示例中 TPS3704x 的电源欠压裕度和精度。使用低精度监控器会占用电源纹波和瞬态响应的可用预算。这降低了用户的灵活性，使直流/直流转换器设计更加严格。

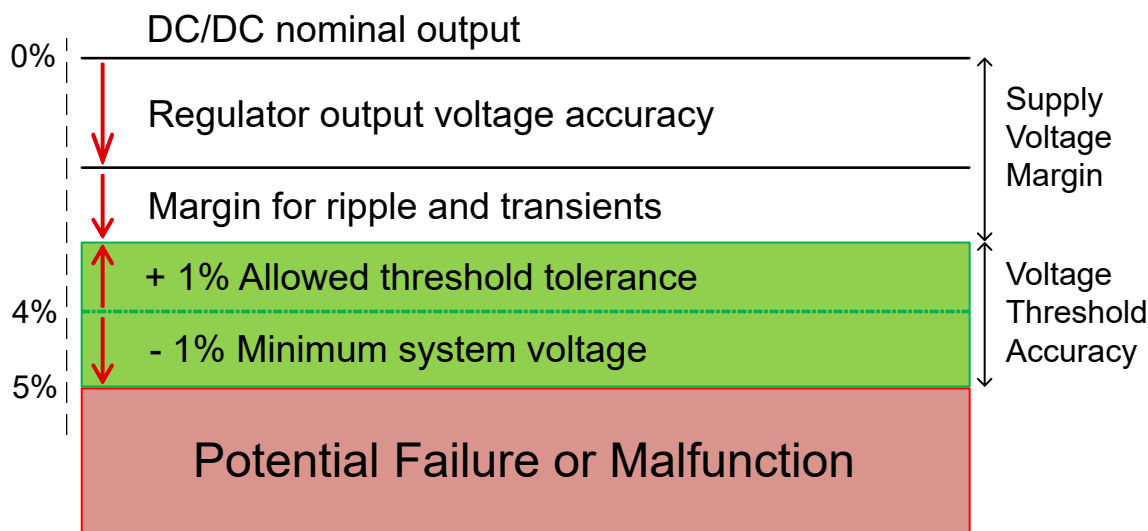


图 8-1. TPS3704x 电压阈值精度

8.1.2 可调电压阈值

TPS3704x 最大精度 (1%) 允许使用外部电阻器调节电压阈值，而不会增加器件的主要误差。在所需监控电压不可用的情况下，可以使用外部电阻分压器来设置所需的电压阈值。图 8-2 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。如需获取计算外部电阻值方面的协助，请访问 [TPS3704](#) 产品页面“设计工具和仿真”部分中的 [TPS3704 可调节阈值电压电阻器计算器](#)。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。由于内部电阻梯的旁路模式，TI 建议使用可调电压阈值器件型号。

例如，考虑使用 TPS3704 0.8V 可调型号来监测 2.0V 电源轨 (V_{MON})。根据 [方程式 2](#)，如果 $R_2 = 10\text{k}\Omega$ 、 $V_{MON} = 2\text{V}$ 且 $V_{SENSE1} = 0.8\text{V}$ ，则 $R_1 = 15\text{k}\Omega$ 。此器件通常用于在 $\pm 4\%$ 电压阈值下监控 0.8V 电压轨。这意味着器件的欠压阈值 ($V_{IT-(UV)}$) 和过压阈值 ($V_{IT+(OV)}$) 分别为 0.768V 和 0.832V。根据 [方程式 2](#)，当 $V_{SENSE1} = V_{IT-(UV)}$ 时， $V_{MON} = 1.92\text{V}$ 。这可以表示为 V_{MON-} ，即受监控的欠压阈值，器件会在此阈值处将复位信号置为有效。同样根据 [方程式 2](#)，当 $V_{SENSE1} = V_{IT+(OV)}$ 时，受监控的欠压阈值 (V_{MON+}) 为 2.08V。如果需要更宽的容差或仅使用 UV 阈值，请使用

[表 9-2](#) 所示的器件型号来确定哪个器件型号与您的应用相匹配。

$$V_{SENSE1} = V_{MON} \times (R_2 / (R_1 + R_2)) \quad (2)$$

在调节电压阈值时必须考虑到一些误差。除了电阻分压器的容差外，SENSE1 引脚还有一个内部电阻，该电阻可能会影响电阻分压器的精度。尽管预计阻抗非常高，但建议用户计算设计规格的值。内部检测电阻 R_{SENSE1} 可以通过将检测电压 V_{SENSE1} 除以检测电流 I_{SENSE1} 来计算得出，如 [方程式 4](#) 所示。 V_{SENSE1} 可以使用 [方程式 2](#) 来计算，具体取决于电阻分压器和受监控的电压。 I_{SENSE1} 可以使用 [方程式 3](#) 来计算。

$$I_{SENSE1} = [(V_{MON} - V_{SENSE1}) / R_1] - (V_{SENSE1} / R_2) \quad (3)$$

$$R_{SENSE1} = V_{SENSE1} / I_{SENSE1} \quad (4)$$

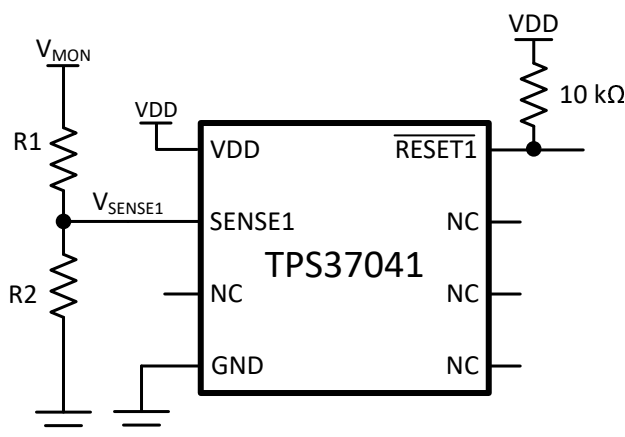


图 8-2. 可通过外部电阻分压器调节电压阈值

8.2 典型应用

8.2.1 设计 1：适用于微控制器电源轨的多轨窗口监控技术

图 8-3 展示了 TPS37042 的典型应用。TPS37042 用于监控两个 PMIC 电压轨，这些电压轨负责为微控制器的内核和 I/O 电压供电，并且微控制器需要精确的复位延迟和电压监控。它利用 TPS37042 来监控 MCU 的内核电压轨，与以下电路类似。

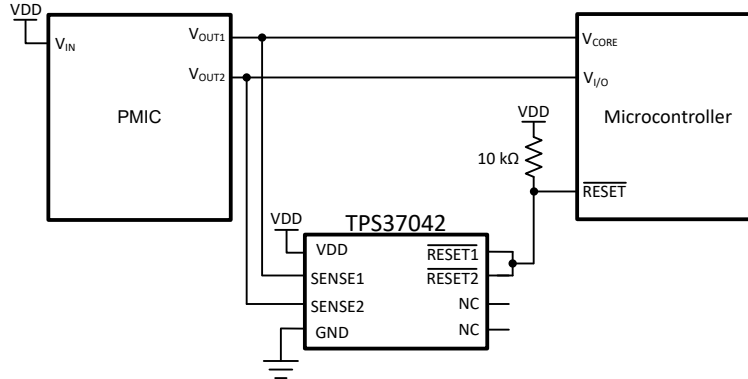


图 8-3. TPS37042 双通道监控两个微控制器电源轨

8.2.1.1 设计要求

表 8-1. 设计要求

参数	设计要求	设计结果
受监控电源轨	3.3V $V_{I/O}$ 标称值，如果超出 $3.3V \pm 8\%$ (包括器件精度)，则会发出警报，10ms 复位延迟	最坏情况 $V_{IT+(OV)} = 3.533V$ (7.06%) 最坏情况 $V_{IT-(UV)} = 3.071V$ (-6.94%)
	1.2V V_{CORE} 标称值，如果超出 $1.2V \pm 5\%$ (包括器件精度)，则会发出警报，10ms 复位延迟	最坏情况 $V_{IT+(OV)} = 1.2484V$ (4.03%) 最坏情况 $V_{IT-(UV)} = 1.1524V$ (-3.97%)
输出逻辑电压	5V CMOS	5V CMOS
最大系统监控电流消耗	25μA	5.5μA (最大值 15μA)

8.2.1.2 详细设计过程

确定 TPS3704x 的哪个型号最适合受监控电源轨 (V_{MON}) 和表 9-2 上的窗口容差。TPS3704x 支持对 0.4V 至 5.55V 之间的常见电压轨进行过压和欠压监控，从而对其进行精确的电压监控。此应用需要对电压轨进行非常严格的监控，在 1.2V V_{CORE} 电压轨上仅允许 $\pm 5\%$ 的变化。为了确保满足此要求，这里选择了 TPS37042，因为它具有 $\pm 3\%$ 的阈值。3.3V $V_{I/O}$ 更加灵活，可以在高达 8% 的变化范围内运行。由于 TPS3704x 提供各种容差选项，因此可以为此电压轨选择 $\pm 6\%$ 阈值。为了计算最坏情况下的 $V_{IT+(OV)}$ 和 $V_{IT-(UV)}$ ，还必须考虑精度。最坏情况下的 $V_{IT+(OV)}$ 和 $V_{IT-(UV)}$ 可以分别按照方程式 5 和方程式 6 所示进行计算：

$$V_{IT+(OV-Worst Case)} = V_{MON} \times (1 + \%Threshold) \times (1 + \%Accuracy) = 1.2 \times (1.03) \times (1.01) = 1.2484V \quad (5)$$

$$V_{IT-(UV-Worst Case)} = V_{MON} \times (1 - \%Threshold) \times (1 - \%Accuracy) = 1.2 \times (0.97) \times (0.99) = 1.1524V \quad (6)$$

在确定 OV 和 UV 阈值时还需要考虑迟滞，以便故障后的释放点高于电源容差限值。有关更多详细信息，请参阅图 6-1。

当输出切换至高阻抗状态时， $\overline{RESETx}/RESETx$ 引脚的上升时间取决于该节点上的上拉电阻和电容。选择的上拉电阻既要满足下游时序要求，又应满足应用具有足够低 V_{OL} 时所需的灌电流；10kΩ 至 1MΩ 电阻器是低电容负载的不错选择。

8.2.2 设计 2：适用于增强型功能安全用例的手动自检选项

图 8-4 展示了一种自检方案，其中可以实现手动自检功能。任何 SENSEx 引脚都可以保留并用于触发要在输出端观察的故障，从而对 TPS3704 进行故障检测预先检查。TPS3704 是一款符合功能安全标准的多通道监控器，使工厂自动化和电机驱动等应用能够达到 IEC 61508 要求和工业安全完整性等级。此示例使用 TPS37044F，该器件配置为单独的欠压和过压 (SENSE4/OV) 输出，其中 SENSE4 的 UV 阈值设置为 5.5V，UV 阈值设置为 2V。

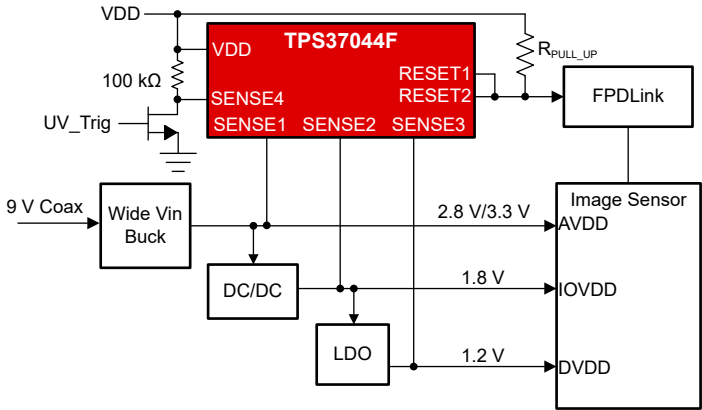


图 8-4. TPS37044F 四通道监控，具有用于功能安全的手动自检选项

8.2.2.1 设计要求

表 8-2. 设计要求

参数	设计要求	设计结果
受监控电源轨	3.3V AVDD 标称值，如果超出 $3.3V \pm 4\%$ (包括器件精度)，则会发出警报，10ms 复位延迟	最坏情况 $V_{IT+(OV)} = 3.432V (+4\%)$ 最坏情况 $V_{IT-(UV)} = 3.168V (-4\%)$
	1.8V IOVDD 标称值，如果超出 $1.8V \pm 4\%$ (包括器件精度)，则会发出警报，10ms 复位延迟	最坏情况 $V_{IT+(OV)} = 1.872V (+4\%)$ 最坏情况 $V_{IT-(UV)} = 1.728V (-4\%)$
	1.2V DVDD 标称值，如果超出 $1.2V \pm 4\%$ (包括器件精度)，则会发出警报，10ms 复位延迟	最坏情况 $V_{IT+(OV)} = 1.248V (+4\%)$ 最坏情况 $V_{IT-(UV)} = 1.152V (-4\%)$
SENSE4 (自检选项)	100kΩ 上拉电阻连接到 VDD，NFET 下拉晶体管连接到 GND	UV_Trigger = 高电平 - 导致 SENSE4 引脚变为低电平 UV_Trigger = 低电平 - 正常运行
输出逻辑电压	5V CMOS	5V CMOS
最大系统 IDD 电流	25μA	5.5μA (最大值 20μA)

8.2.2.2 详细设计过程

图 8-4 展示了一种自检方案，其中可以实现手动自检功能。SENSE4 的过压 (OV) 阈值设置为 5.5V，欠压 (UV) 阈值设置为 2V。SENSE4 可通过 100kΩ 电阻器连接至 VDD。该自检设置提供了一个额外的优势，即针对为 TPS37044F 供电的电源轨具有内置的过压检测器。从功能安全的角度来看，如果电压监控器在其建议的工作限值之外运行，则不能认为电压监控器是可靠的。

要触发手动自检，请将 UV_Trigger 拉高以使 SENSE4 处于逻辑低电平，从而触发欠压 (UV) 故障。UV 故障在 RESET2 上以置为低电平的信号形式出现。通过将两个复位输出连接至处理器的 NMI 或中断输入，此自检选项方案可用于确保 TPS37044F 的 RESET2 正常运行。有关功能安全的更多信息，请参阅[功能安全手册](#)。

8.2.3 应用曲线

这些应用曲线是使用 TPS3704Q1EVM 获取的。有关更多信息，请参阅 [TPS3704Q1EVM 用户指南](#)。

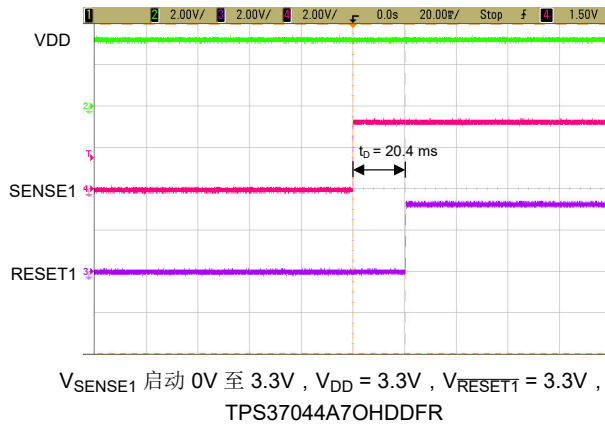


图 8-5. TPS37044 SENSE1 启动功能

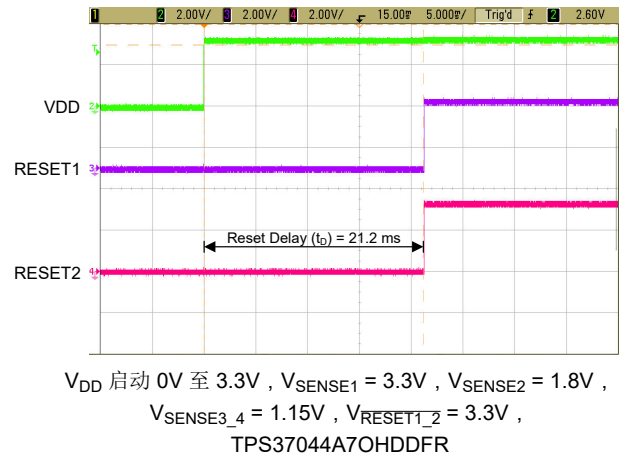


图 8-6. TPS37044 VDD 启动功能

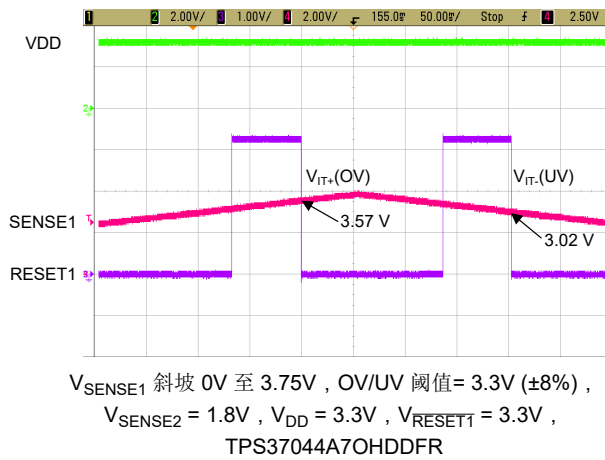


图 8-7. TPS37044 过压和欠压功能

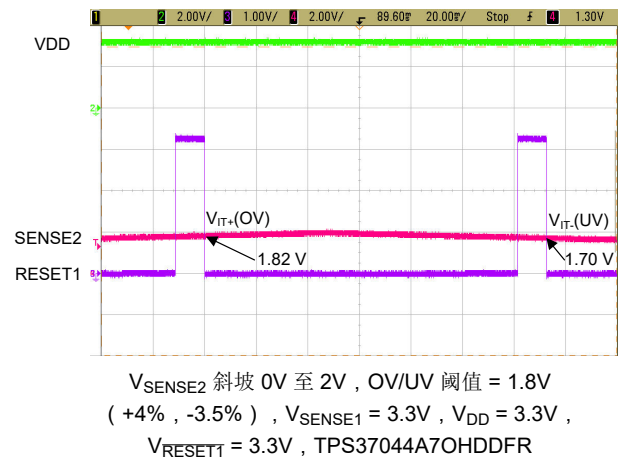


图 8-8. TPS37044 过压和欠压功能

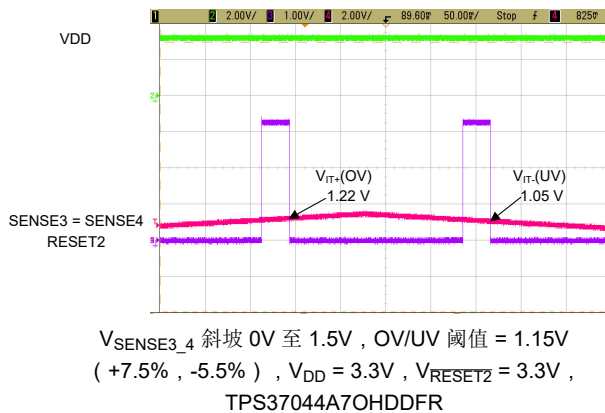


图 8-9. TPS37044 过压和欠压功能

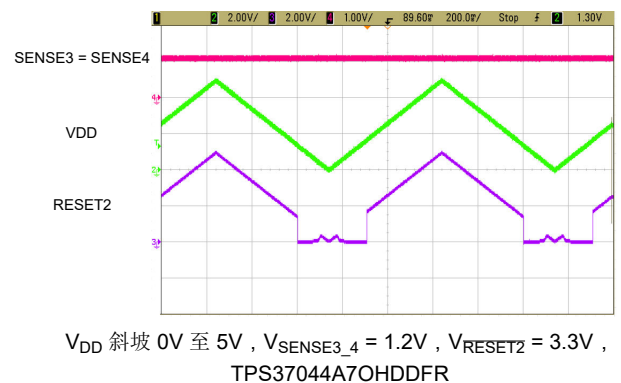
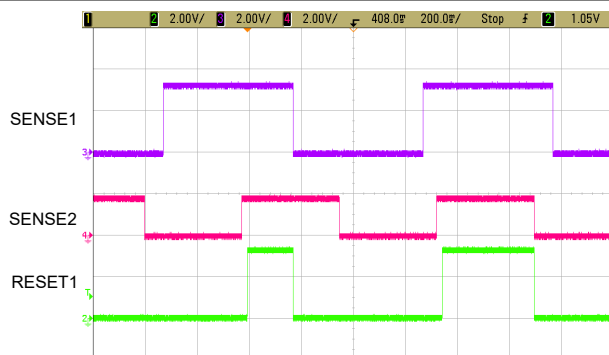


图 8-10. TPS37044 VDD 斜升功能

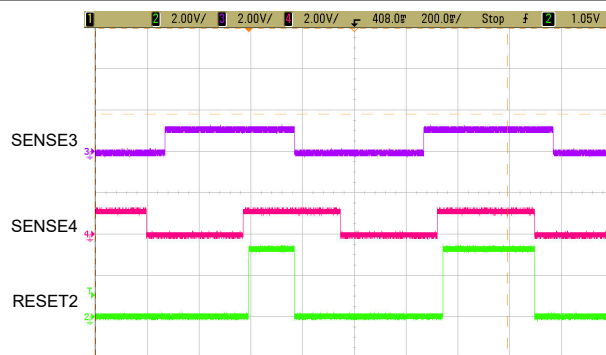
TPS3704

ZHCS0H1E - MARCH 2021 - REVISED DECEMBER 2023



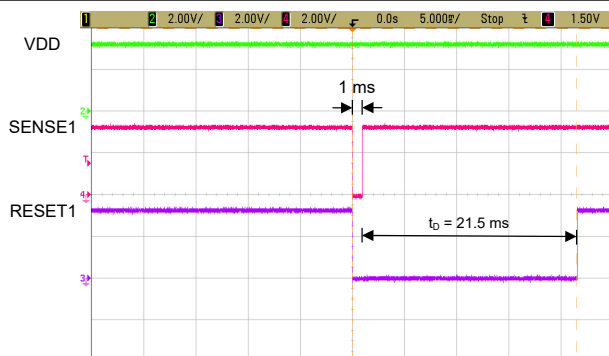
V_{SENSE1} 切换 0V 至 3.3V [OV/UV 阈值 = 3.3V ($\pm 8\%$)],
 V_{SENSE2} 从 0V 切换至 1.8V [OV/UV
 阈值 = 1.8V (+4%, -3.5%)], $V_{DD} = 3.3V$,
 $V_{RESET1} = 3.3V$, TPS37044A7OHDDFR

**图 8-11. TPS37044 SENSE 1 和
SENSE 2 切换**



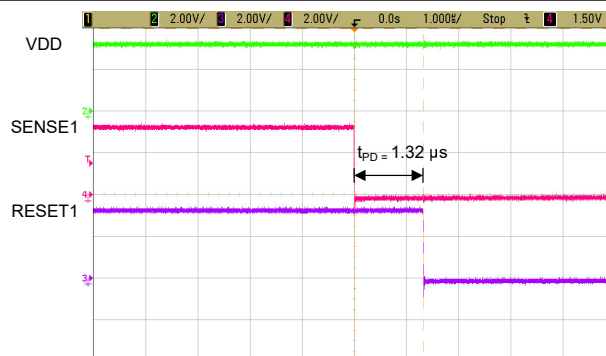
V_{SENSE3} 切换 0V 至 1.15V [OV/UV 阈值 = 1.15V
 (+7.5%, -5.5%)], V_{SENSE4} 从 0V 切换至 1.15V
 [OV/UV 阈值 = 1.15V (+7.5%, -5.5%)], $V_{DD} = 3.3V$,
 $V_{RESET1} = 3.3V$, TPS37044A7OHDDFR

**图 8-12. TPS37044 SENSE 3 和
SENSE 4 切换**



$V_{SENSE1} = 3.3V$, $V_{SENSE1} = 0V$, 通过按钮持续 1ms,
 $V_{DD} = 3.3V$, $V_{RESET1} = 3.3V$, TPS37044A7OHDDFR

**图 8-13. TPS37044 SENSE1 具有复位延时时间的按钮
监控功能**



V_{SENSE1} 从 3.3V 切换至 0V, $V_{DD} = 3.3V$, V_{RESET1} 从 3.3V 切
 换至 0V, TPS37044A7OHDDFR

**图 8-14. TPS37044 SENSE1
传播延迟功能**

8.3 电源相关建议

8.3.1 电源指南

该器件可由电压范围介于 1.7V 至 6V 之间的输入电源供电。该器件在 VDD 引脚上具有 6.5V 的绝对最大额定值。良好的模拟实践是根据输入电压电源噪声，在 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个 0.1μF 至 1μF 的电容器。如果为 VDD 供电的电压电源易受任何超过最大规格的大电压瞬变的影响，则必须采取额外的预防措施。有关详情，请参阅 [SNVA849](#)。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

- 外部元件应尽量靠近器件放置。该配置可防止发生寄生误差。
- 避免对 VDD 电源节点使用长布线。VDD 电容器以及从电源到电容器的寄生电感可以形成 LC 电路，并产生峰值电压高于最大 VDD 电压的振铃。
- 避免使用较长的布线将电压输入到检测引脚。长布线会增加寄生电感并导致监控和诊断不准确。
- 如果使用了 SENSEx 电容器 (C_{SENSEx})，请将电容器尽可能靠近 SENSEx 引脚放置，以进一步提高 SENSEx 引脚上的抗噪性能。在 SENSEx 引脚和 GND 之间放置一个 10nF 至 100nF 的电容器可以降低对受监控信号上瞬态电压的敏感度。
- 模拟布线敏感，不能与数字布线平行。尽可能避免数字布线与模拟布线交叉，仅在必要时可垂直交叉布线。

8.4.2 布局示例

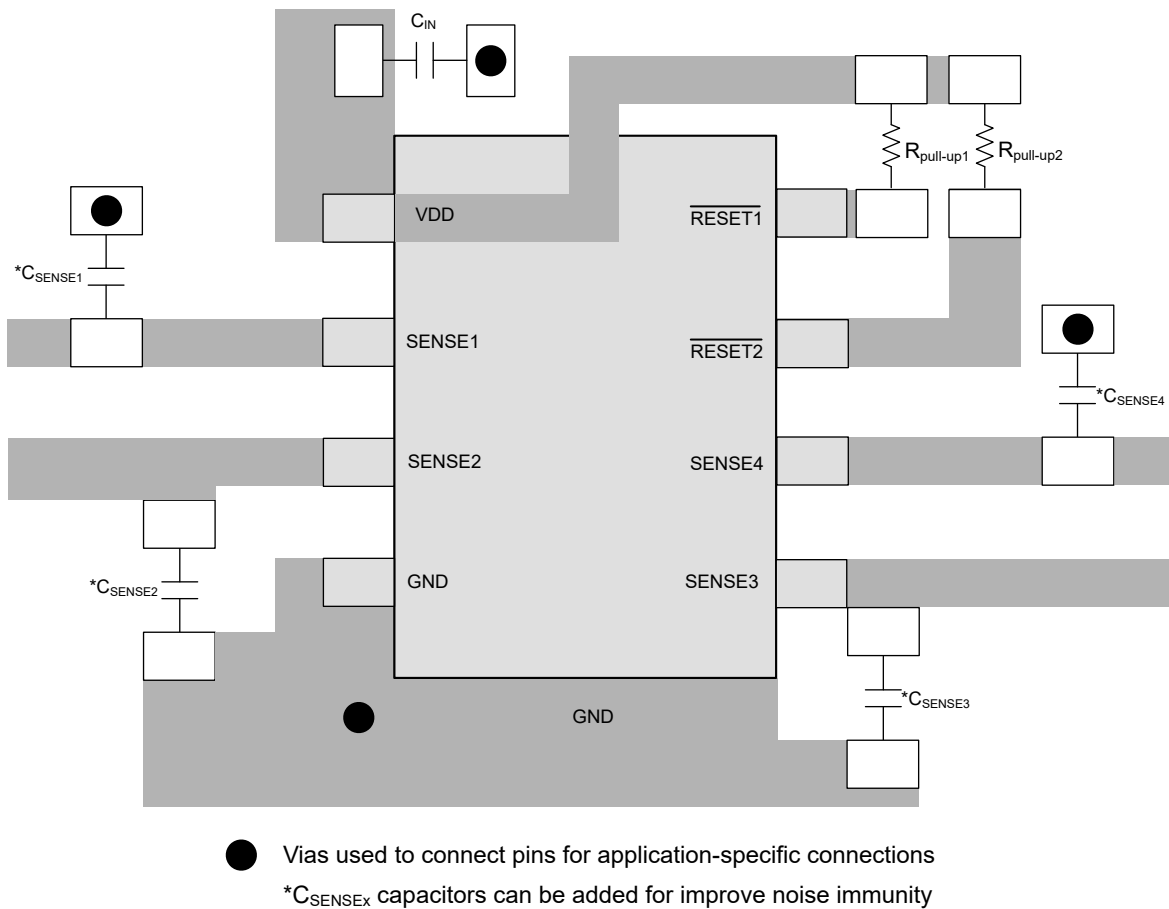


图 8-15. 建议布局

9 器件和文档支持

9.1 器件命名规则

节 4 中的图 4-1 和表 9-1 展示了如何根据表 9-2 中所示的器件型号来解码器件的功能。

表 9-1. 器件命名约定

说明	命名规则	值
通用器件型号	TPS3704x	TPS3704x
通道选项	1	单通道选项
	2	双通道选项
	3	三通道选项
	4	四通道选项
检测选项	AX、Bx、CX、...	请参阅表 9-2
型号代码 (输出拓扑)	O	漏极开路, 低电平有效
	L	推挽, 低电平有效
	H	推挽, 高电平有效
复位延时时间选项	A	20 μ s 复位延时时间
	B	1ms 复位延时时间
	C	2ms 复位延时时间
	D	3ms 复位延时时间
	E	5ms 复位延时时间
	F	10ms 复位延时时间
	G	15ms 复位延时时间
	H	20ms 复位延时时间
	I	25ms 复位延时时间
	J	35ms 复位延时时间
	K	40ms 复位延时时间
	L	50ms 复位延时时间
	M	70ms 复位延时时间
	N	100ms 复位延时时间
	O	140ms 复位延时时间
	P	150ms 复位延时时间
	R	200ms 复位延时时间
	S	280ms 复位延时时间
	T	400ms 复位延时时间
	U	560ms 复位延时时间
	V	800ms 复位延时时间
	W	1120ms 复位延时时间
	X	1200ms 复位延时时间
封装	DDF	SOT-23 8 引脚 (1.6mm × 2.9mm)
卷带	R	大卷带

表 9-2. 器件阈值表

可订购器件名称	型号 ⁽³⁾	通道数量	复位时间	SENSE1 ^{(1) (2)}	SENSE2 ^{(1) (2)}	SENSE3 ^{(1) (2)}	SENSE4 ^{(1) (2)}
TPS37042BJOFDDFRQ1	ADJ	2	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	-	-
TPS37042A3OFDDFRQ1	修复	2	10ms	3.3V (±5%)	1.2V (±5%)	-	-
TPS37042ZJOFDDFRQ1	修复	2	10ms	1.95V (±4%)	3.8V (±6%)	-	-
TPS37043DJOFDDFR	可调/固定	3	10ms	3.3V (-11%)	1.2V (-11%)	0.8V (-8%)	-
TPS37043A4OFDDFRQ1	修复	3	10ms	2.8V (±5%)	1.8V (±5%)	1.2V (±5%)	-
TPS37043A8OFDDFRQ1	修复	3	10ms	3.3V (±5%)	1.8V (±5%)	1.0V (±5%)	-
TPS37043CPOFDDFRQ1	可调/固定	3	10ms	3.3V (±4%)	0.75V (±4%)	0.8V (±3%)	-
TPS37043ZJOFDDFRQ1	修复	3	10ms	0.95V (±4%)	1.35V (±4%)	1.8V (±4%)	-
TPS37043LJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.4V (±5%)	0.4V (±5%)	0.8V (±5%)	-
TPS37043CJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	-
TPS37043MJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.4V (±7%)	0.4V (±7%)	0.8V (±7%)	-
TPS37043A5OFDDFRQ1	修复	3	10ms	3.3V (±4%)	1.8V (±4%)	1.2V (±4%)	-
TPS37043BJOFDDFRQ1	ADJ	3	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	-
TPS37044BJOFDDFR	ADJ	4	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)
TPS37044LJOJDDFR	ADJ	4	35ms	0.4V (±5%)	0.4V (±5%)	0.8V (±5%)	0.8V (±5%)
TPS37044BJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)	0.8V (±4%)
TPS37044CJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)	0.8V (±6%)
TPS37044MJOFDDFRQ1	ADJ	4	10ms	0.4V (±7%)	0.4V (±7%)	0.8V (±7%)	0.8V (±7%)
TPS37044A4OGDDFRQ1	修复	4	15ms	3.3V (±8%)	1.8V (±4%)	1.15V (±6%)	1.15V (±6%)

- (1) 所列百分比表示窗口容差，请参阅图 6-1 以了解更多信息。
 (2) 0.8V 和 0.4V 的 VIT 阈值表示可调通道。
 (3) ADJ 表示由外部电阻分压器设置的可调电压阈值，请参阅节 8.1.2 以了解更多信息。

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
 所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision D (September 2022) to Revision E (December 2023)	Page
• 从器件阈值表中删除了 TPS37044UJOFDDFR 和 TPS37044GJONDDFR.....	3
• 删除了单通道引脚排列.....	5
• 从器件阈值表中删除了 TPS37044UJOFDDFR 和 TPS37044GJONDDFR.....	28

Changes from Revision C (September 2022) to Revision D (September 2023)	Page
• 在窗口容差规格中添加了阐述文本.....	1
• 突出了器件阈值表和计算器工具的存在.....	1
• 删除了对单通道的引用并精简了措辞.....	1
• 添加了表 4-1	3
• 在图 6-1 窗口容差规格中添加了阐述文本.....	10
• 删除了单通道监控器相关内容.....	16
• 删除了单通道方框图.....	16
• 添加了可调节阈值电阻器计算器相关内容.....	22
• 向表 9-2 中添加了可订购器件名称.....	28

Changes from Revision B (November 2021) to Revision C (September 2022)	Page
• 添加了“功能安全”信息.....	1
• 添加了“手动自检选项”部分.....	24

Changes from Revision A (July 2021) to Revision B (November 2021)	Page
• 将“预告信息”更改为“量产数据”	1

11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS37043DJOFDDFR	ACTIVE	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	3DJOF	Samples
TPS37044BJOFDDFR	ACTIVE	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	4BJOF	Samples
TPS37044LJOJDDFR	ACTIVE	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	4LJOJ	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS3704 :

- Automotive : [TPS3704-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

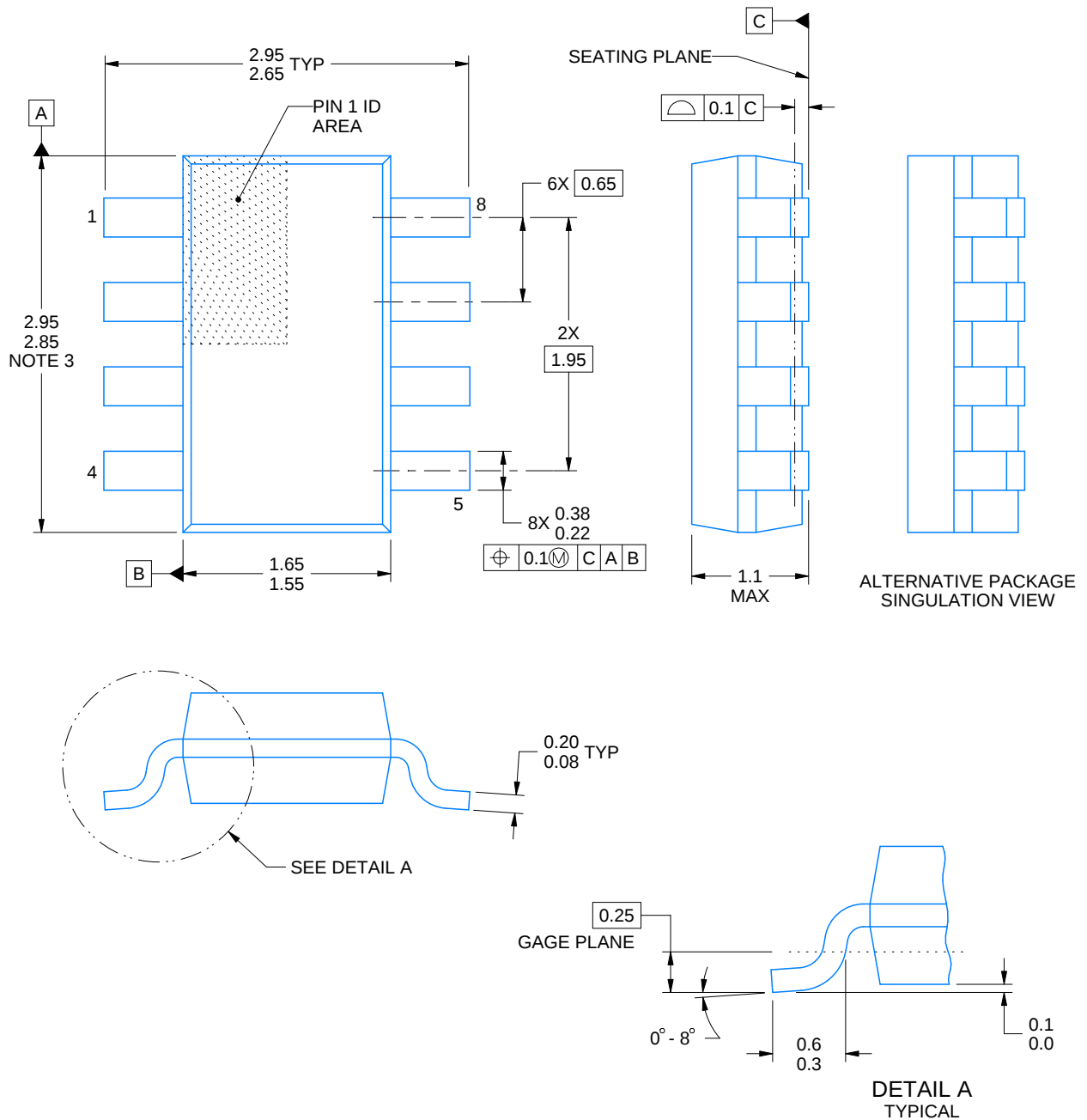
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS37043DJOFDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS37044BJOFDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS37044LJOJDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS37043DJOFDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
TPS37044BJOFDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
TPS37044LJOJDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0



4222047/D 04/2024

NOTES:

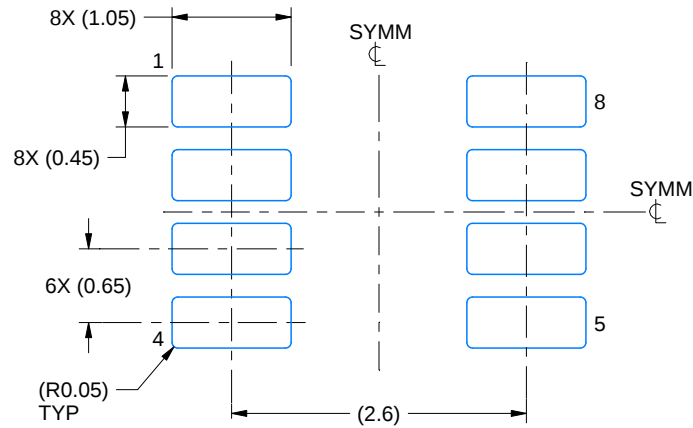
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

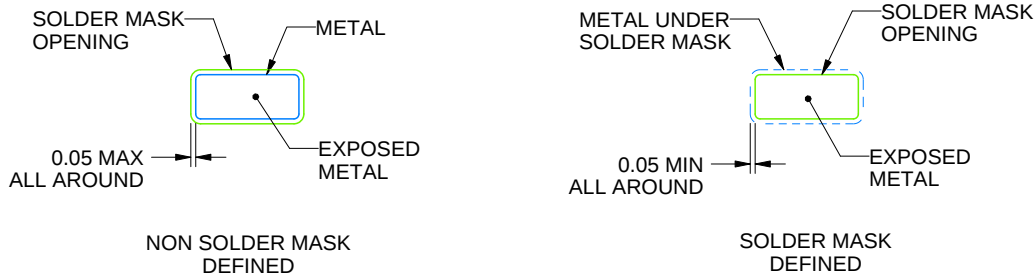
DDF0008A

SOT-23 - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4222047/D 04/2024

NOTES: (continued)

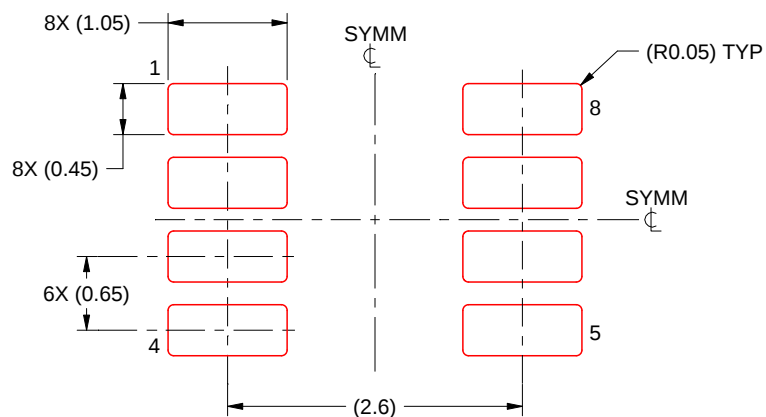
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DDF0008A

SOT-23 - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4222047/D 04/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司